

接着・封止材

Weekly Intelligence Report

2026-07-25 | 21件 | 7カ国

troy-technical.jp

今週のキーワード

半導体材料

AI活用とEV向け熱管理が加速

21

件
記事数

7

カ国
対象国

6.5

W/mK
熱伝導率

45+

社
AI材料PF

今週的全21記事 — 5軸評価で読むべき記事を選ぶ

各列の見方 — 技術新規性：ブレイクスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#01	ダウ、黒字転換	企業戦略						ダウがポリエチレン価格上昇とコスト削減で黒字転換、特殊化学品への注力継続を表明。
#02	Durante Adesivi買収	企業戦略						Durante AdesiviがAdvatac買収で英国木工用接着剤製造拠点を拡大、欧州市場でのプレゼンスを強化。
#03	ダウ、シリコン増産	企業戦略						ダウが約1億ドルを投じ、米国・中国・日本でEVやエレクトロニクス向け特殊シリコン生産能力を拡大。
#04	ヘンケル、熱ギャップF	新製品						ヘンケルがEV・ADAS向けに熱伝導率6.5W/mKの次世代熱ギャップフィラーを発表、高電力密度化に対応。
#05	ヘンケル、AIシミュ	市場概観						金属接合用接着剤市場がEV・航空宇宙の軽量化で成長、ヘンケルはAIシミュレーションでEVバッテリー開発を加速。
#06	エポキシ特許動向	技術動向						エポキシ構造接着剤の特許は3Mが主導、自動車・航空宇宙の多材料接着が課題でDowとIBMがエレクトロニクスで協業。
#07	WLP市場予測	市場概観						ウェハーレベルパッケージング市場が2035年に288.1億ドルへ成長予測、チップ小型化と熱効率向上が牽引。
#08	APPLIED Adhesives買収	企業戦略						APPLIED AdhesivesがISD買収でシリコンソリューションと米国東海岸のプレゼンスを拡大。
#09	Kansai Nerolac提携	企業戦略						Kansai NerolacがDurante Adesiviと提携し、インド接着剤市場でホットメルト技術を強化。
#10	感圧接着剤市場	市場概観						感圧接着剤市場はアクリル樹脂が支配、DowとHenkelが排出量削減で連携し環境対応製品開発を加速。
#11	シリコンフリーTIM	技術比較						Sheen TechnologyがEV・AIハードウェア向けにシリコンフリーで打ち抜き可能な熱伝導材料の選定ガイドを公開。
#12	CuspAI、AI材料PF	学術的ブレイクスルー						CuspAIがAI Materials Foundryを立ち上げ、レゾナック含む45超のパートナーとAIで半導体・エネルギー材料発見を加速。
#13	H.B. Fuller買収	企業戦略						H.B. FullerがAdvanced Medical Solutionsを約6.6億ポンドで買収し、医療接着剤技術とグローバルプレゼンスを強化。
#14	Lenovoゲーミング冷却	製品紹介						Lenovoがゲーミングフォンに12W/mK液体金属と高熱伝導性ゲルを搭載し、冷却性能を大幅強化。

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#15	BGAアンダーフィル	技術比較	●●○○○ ○	●●●●● ●	●●●○○ ○	●●●○○ ○	●●●○○ ○	AtlasPCBがBGAアンダーフィルの選定ガイドを公開、キャピラリーフローとリワーク可能処方を比較し信頼性向上を支援。
#16	CPWボンブ市場予測	市場概観	●○○○○ ○	●●●●● ●	●●●●● ○	●●●○○ ○	●●●●● ○	CPWボンブ市場が半導体・エレクトロニクス製造の成長に牽引され2035年まで年平均6.8%で成長予測。
#17	Intel、PKGエンジニア	企業戦略	●●○○○ ○	●●●○○ ○	●●●●● ○	●●●○○ ○	●●●●● ○	Intelがマレーシアで先進パッケージングテスト工程エンジニアを募集、CUFモジュール改良と新材料適用を推進。
#18	シリコンフォーム市場	市場概観	●○○○○ ○	●●●●● ●	●●●●● ○	●●●○○ ○	●●●●● ○	リチウム電池パック用シリコンフォーム市場が熱暴走規制強化で2035年まで成長、EVバッテリーが最大用途。
#19	SK hynix、HBM増産	企業戦略	●●○○○ ○	●●●○○ ○	●●●●● ●	●●●●● ○	●●●●● ○	SK hynixがHBM3需要急増に対応するため、米国インディアナ州に先進パッケージングプラントを建設。
#20	GM、接着剤厳格指示	解説記事	●●○○○ ○	●●●●● ●	●●○○○ ○	●●●○○ ○	●●●○○ ○	GMがCorvette C8の修理に特定の構造用接着剤を厳格指示、高性能車の安全な修理における接着技術の重要性を示す。
#21	チップレットUF市場	市場概観	●●●○○ ○	●●●○○ ○	●●●●● ○	●●●○○ ○	●●●●● ○	チップレットアンダーフィルディスパensing市場がHBM・C2Wハイブリッドボンディングのボイド低減ニーズで2036年まで成長。

●●●●● High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色 = 注目記事

今週、判断に影響しうる3つの問い

① AIによる材料開発は、自社のR&D;戦略をどう変えるべきか？

CuspAIがレゾナックを含む45社超とAI材料探索プラットフォームを立ち上げ、半導体・エネルギー分野で新材料発見を加速する動きは、従来の材料開発プロセスを根本から変える可能性を秘めています。貴社のR&D;部門は、このAI駆動型アプローチをどのように取り入れ、競争優位性を確立する計画でしょうか？

② EV・ADASの熱管理材料は、既存製品の性能限界を突破できるか？

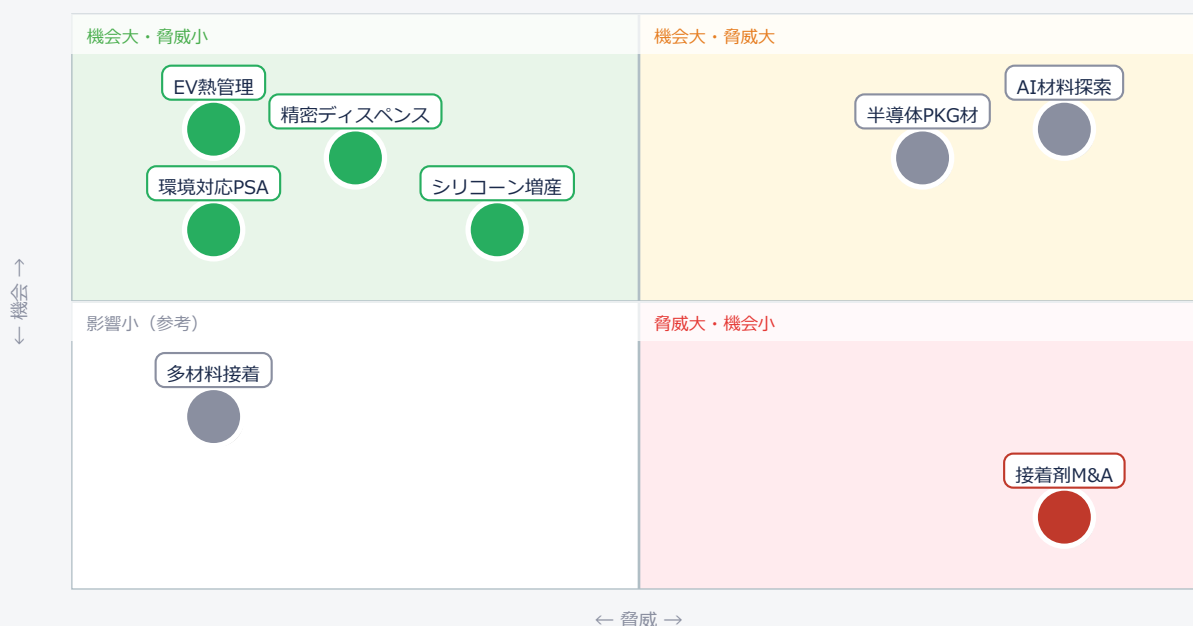
ヘンケルが6.5W/mKの高熱伝導率ギャップフィラーを発表し、Sheen Technologyがシリコンフリー熱伝導材料の選定ガイドを公開するなど、EV・ADAS向け熱管理材料の進化が加速しています。高電力密度化と信頼性向上の要求に対し、貴社の熱管理ソリューションは十分な性能と環境適合性を提供できていますか？

③ グローバルなサプライチェーン再編と国内投資の動きにどう対応するか？

ダウが日本を含むグローバルで特殊シリコン生産能力を拡大し、SK hynixが米国にHBM先進パッケージングプラントを建設するなど、主要材料・半導体メーカーがサプライチェーンの強靱化と地域分散を進めています。これらの動きは、貴社の調達戦略や国内生産体制にどのような影響を与え、どのような対応が求められるのでしょうか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス



項目	象限	↑ 機会	↓ 脅威
● AI材料探索	注意	開発期間短縮、新材料創出	競争激化、AI技術格差
● EV熱管理	機会大	高性能材需要増、新製品	性能要求高度化
● 半導体PKG材	注意	先進PKG材需要増	技術変化速い、供給網再編
● シリコン増産	機会大	安定調達、市場拡大	競合激化、原材料価格
● 環境対応PSA	機会大	環境規制対応、新市場	開発コスト、技術難度
● 接着剤M&A;	脅威大	市場再編、提携機会	競争激化、市場奪取
● 多材料接着	参考	新規ソリューション	技術難度、標準化

● 精密ディスペンス	機会大	装置需要増	高精度化要求
------------	-----	-------	--------

深掘り ① — AIが材料科学を加速：レゾナックも参画

#12 | 2026/07/20 | Morningstar | 技術新規性●●●●● 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

CuspAIが「AI Materials Foundry」を立ち上げ、半導体、エネルギー、気候変動分野での画期的な材料発見を加速します。このグローバルネットワークにはNVIDIAやMetaを含む45以上のパートナーが参画し、AI駆動型の科学的発見を通じて産業界の課題解決を目指します。日本のレゾナック・ホールディングスも創設メンバーとして参加しており、AIが先進材料の発見と開発を変革する可能性に期待が寄せられています。

AI Materials Foundryは、AIシミュレーションとデータ分析により、従来の実験ベースのアプローチよりもはるかに迅速に、特定の性能要件を満たす新材料を特定・最適化することを目的としています。これにより、材料開発のボトルネックを解消し、イノベーションのペースを加速させることが期待されます。レゾナックは、半導体材料や高機能化学品分野での専門知識と製造ノウハウを提供し、AIを活用した新しい半導体パッケージング材料や熱管理材料の探索に貢献します。

▶ 技術者の視点

【技術者の視点】AIによる材料探索は、従来の試行錯誤型開発を劇的に変える可能性を秘めています。CuspAIのプラットフォームは、理論計算と実験データを統合し、膨大な化学空間から最適な材料を効率的に探索する点で画期的です。ただし、AIが提案する材料が実際に合成可能か、また工業生産スケールでコストに見合うかという実用化の課題は残ります。レゾナックの参画は、日本の材料メーカーがこの最先端技術を取り込み、国際競争力を維持する上で大きな【機会】です。一方で、AI技術の導入が遅れる企業は、新材料開発競争で【脅威】に直面するでしょう。R&D部門は、AIツールへの投資と、それを使いこなすデータサイエンティストの育成を急ぐ必要があります。

深掘り ② — EV・ADAS向け高熱伝導率ギャップフィラー

#04 | 2026/07/22 | EuropaWire | 技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●○

ヘンケルは、熱伝導率6.5W/m・Kを誇る次世代熱ギャップフィラー「Bergquist Gap Filler TGF 6500LVO」を発売しました。この2成分シリコンベースの材料は、電気自動車（EV）、先進運転支援システム（ADAS）、および電子制御ユニット（ECU）などの高電力密度アプリケーションにおける熱管理を大幅に改善します。これにより、高まる熱負荷に対応し、電子コンポーネントの信頼性と寿命向上に貢献します。

本製品は、市場をリードする6.5W/m・Kの熱伝導率を提供し、熱源からヒートシンクへの効率的な熱伝達を可能にします。2成分シリコンベースであり、硬化後の優れた柔軟性と信頼性を提供。低いボンドライン厚さ（BLT）での使用が可能で、複雑な形状や狭いギャップにも容易に適用でき、優れた密着性を発揮します。EVのバッテリー、モーター、インバーター、ECUなど、高発熱部品の冷却に不可欠なソリューションです。

▶ 技術者の視点

【技術者の視点】6.5W/mKという熱伝導率は、現状の熱ギャップフィラーとしては非常に高いレベルであり、EVやADASの高性能化・小型化に伴う熱問題解決に大きく貢献するでしょう。特に、シリコンベースであるため、既存の塗布プロセスとの親和性も高く、実用化距離に近い点は評価できます。ただし、シリコン系材料特有のアウトガスや低分子シロキサンによる接点汚染リスクは、特に密閉された環境や光学部品近傍での使用において常に考慮すべき課題です。日本の自動車部品メーカーやEVメーカーにとっては、この高性能材料をいかに迅速に評価し、自社の設計に取り入れるかが【機会】となります。一方で、既存の熱管理材料メーカーにとっては、性能面での【脅威】となるため、同等以上の性能を持つ製品開発が急務です。

深掘り ③ — ダウ、特殊シリコン生産能力をグローバル拡大

#03 | 2026/07/19 | K Trade Fair | 技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

ダウは、米国、中国、日本の各拠点に約1億ドルを投資し、特殊シリコンの生産および加工能力を世界的に拡大すると発表しました。この投資は、特にモビリティ、エレクトロニクス、医療技術分野の需要に対応するため、液状シリコンゴム（LSR）やエンジニアリングシリコン材料の能力を増強します。これにより、高成長市場における顧客ニーズへの対応力とサプライチェーンの安定性が強化されます。

投資の大部分は、精密成形が可能なLSRと、優れた耐久性・熱安定性を持つエンジニアリングシリコン材料の能力増強に充てられます。特にアジア市場はエレクトロニクスとモビリティ分野での成長が著しく、この投資は地域の顧客への供給体制を強化します。約1億ドルという投資額は、ダウが特殊シリコン分野を戦略的成長ドライバーと位置づけ、長期的な市場リーダーシップを目指す姿勢を示しています。

▶ 技術者の視点

【技術者の視点】ダウの約1億ドル規模の特殊シリコン増産投資は、EV化や高機能エレクトロニクス化の加速に伴う需要増への明確な対応であり、特に日本での能力増強が含まれる点は日本の製造業にとって大きな【機会】です。LSRやエンジニアリングシリコンは、バッテリーパックのシーリング、センサー保護、熱管理など、多岐にわたる高付加価値アプリケーションで不可欠な材料であり、安定供給は重要です。ただし、シリコン材料は特定の用途でアウトガスや移動の問題が指摘されており、シリコンフリー材料へのシフトも進んでいます（#11参照）。ダウはこれらの課題に対し、どのような技術的アプローチで対応していくのかが注目されます。日本の材料メーカーは、競合の動向を注視しつつ、高機能化と環境適合性を両立する次世代材料の開発を加速させる【脅威】と【機会】に直面しています。

その他の注目記事

SK hynix、米国にHBM先進パッケージングプラント建設（BigGo Finance）

技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●● 日本関連度●●●●○

SK hynixがHBM3需要に対応するため米国に先進パッケージングプラントを建設。AI半導体市場のサプライチェーンに大きな影響を与える。

Sheen Technology、EV・AIハードウェア向け「打ち抜き可能なシリコンフリー熱伝導材料」の選定ガイドを公開（Sheen Technology）

技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○ 日本関連度●●●●○

シリコンのアウトガス問題を回避するシリコンフリーTIMは、EVやAIハードウェアの信頼性向上に不可欠。日本のメーカーも注目すべき技術。

Transpire Insightが金属接合用接着剤市場を分析、ヘンケルはEVバッテリー向けAIシミュレーションで革新を推進（Transpire Insight）

技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○ 日本関連度●●●●○

ヘンケルのAI駆動型デジタルツインシミュレーション「Loctite

Solve」は、EVバッテリー開発の期間短縮とコスト削減に貢献する革新的なアプローチ。

リチウム電池パック用シリコンフォーム市場、熱暴走規制により2035年まで成長予測：EVバッテリーが最大最終用途（IndexBox）

技術新規性●○○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○ 日本関連度●●●●○

EVバッテリーの熱暴走規制強化がシリコンフォーム市場を牽引。日本の電池・EVメーカーは安全性向上への材料採用を加速すべき。

チップレットアンダーフィルディスペンシング市場、HBM・C2Wハイブリッドボンディングのボイド低減ニーズで2036年まで成長（Fact.MR）

技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○ 日本関連度●●●●○

HBMやC2Wハイブリッドボンディングにおけるアンダーフィル技術は、半導体パッケージングの信頼性向上に不可欠。精密ディスペンス技術の進化が鍵。

今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

■ 即時（今週中）

- 【R&D;】 CuspAIの「AI Materials Foundry」の動向を調査し、自社の材料開発プロセスへのAI導入可能性を検討開始。
- 【EV設計/半導体PKG】 ヘンケルの新熱ギャップフィラー（6.5W/mK）のサンプル入手と評価を検討。自社製品への適用可能性を評価。
- 【調達】 ダウの特殊シリコン増産計画（特に日本拠点）の詳細を確認し、今後のサプライチェーン安定性への影響を評価。

■ 短期（1ヶ月）

- 【R&D;】 シリコンフリー熱伝導材料（#11）の技術動向を深掘りし、自社製品の信頼性向上と環境負荷低減の観点から代替材料の検討を開始。
- 【半導体PKG】 HBMおよびチップレット向けアンダーフィル材料（#21）の最新動向を調査し、精密ディスプレイ技術の要求仕様を再確認。
- 【経営企画】 AIを活用した接着剤開発（#05）の事例を分析し、自社のR&D;投資戦略におけるAI技術の優先順位を議論。

■ 中長期（四半期～）

- 【R&D;/経営企画】 AI材料開発プラットフォームへの参画や共同研究の可能性を検討し、長期的な技術ロードマップに組み込む。
- 【EV設計/材料メーカー】 EVバッテリーの熱暴走対策（#18）に関する国内外の規制動向を継続的に監視し、次世代シリコンフォームや代替材料の開発・採用戦略を策定。
- 【経営企画/調達】 接着剤業界のM&A;動向（#13）を分析し、グローバルサプライヤーの再編が自社の調達戦略や競争力に与える影響を評価、必要に応じてパートナーシップ戦略を見直す。

接着・封止材 採用記事全文集

出力日: 2026-07-25

採用記事数: 21 件

収録記事一覧

- #01 ダウ、2026年第2四半期純利益8.02億ドルで黒字転換、ポリエチレン価格上昇とコスト削減が寄与
- #02 Durante Adesivi、Advatac買収により英国木工用接着剤製造拠点を拡大し欧州市場を強化
- #03 ダウ、約1億ドル投資し米国・中国・日本で特殊シリコン生産能力を世界的に拡大
- #04 ヘンケル、EV・ADAS向け高熱伝導率6.5W/m・Kの次世代熱ギャップフィラー「Bergquist Gap Filler TGF 6500LVO」を発表
- #05 Transpire Insightが金属接合用接着剤市場を分析、ヘンケルはEVバッテリー向けAIシミュレーションで革新を推進
- #06 3Mが主導するエポキシ構造接着剤の特許動向、自動車・航空宇宙の軽量化で多材料接着が鍵
- #07 ウェハーレベルパッケージング市場、2035年には288.1億ドルに成長予測：チップ小型化と熱効率向上を牽引
- #08 APPLIED AdhesivesがIndustrial Sales and Distribution買収、シリコンソリューションと米国東海岸のプレゼンスを拡大
- #09 Kansai Nerolac、イタリアのDurate Adesiviと提携しインド接着剤市場でNerofixのプレゼンスを強化
- #10 感圧接着剤市場、アクリル樹脂が支配し環境対応製品開発を加速、DowとHenkelが排出量削減で連携
- #11 Sheen Technology、EV・AIハードウェア向け「打ち抜き可能なシリコンフリー熱伝導材料」の選定ガイドを公開
- #12 CuspAI、「AI Materials Foundry」を立ち上げ、レゾナック含む45超のパートナーと半導体・エネルギー・気候変動の材料発見を加速
- #13 H.B. FullerがAdvanced Medical Solutionsを約6.6億ポンドで買収、医療接着剤技術を強化
- #14 Lenovo Legion Y70 2026ゲーミングフォン、12W/mK液体金属と高熱伝導性ゲルで冷却性能を大幅強化
- #15 AtlasPCB、BGAアンダーフィル選定ガイドを公開、キャピラリーフローとリワーク可能処方と比較
- #16 CPWポンプ市場、半導体・エレクトロニクス製造の成長で2035年までに高みへ到達予測
- #17 Intel、マレーシア・クリムで先進パッケージングテスト工程エンジニアを募集、CUFモジュール改良と新材料適用を推進
- #18 リチウム電池パック用シリコンフォーム市場、熱暴走規制により2035年まで成長予測：EVバッテリーが最大最終用途

#19 SK hynix、米国インディアナ州に先進パッケージングプラントを建設、HBM3需要急増に対応

#20 Corvette C8のリアインパクトバー交換でGMが「特定の接着剤」の使用を厳格指示、安全な修理を保証

#21 チップレットアンダーフィルディスペンシング市場、HBM・C2Wハイブリッドボンディングのボイド低減ニーズで2036年まで成長

#01 ダウ、2026年第2四半期純利益8.02億ドルで黒字転換、ポリエチレン価格上昇とコスト削減が寄与

公開日 2026年07月23日 Dow Company (PR Newswire, Moomoo, BNN Bloomberg) アメリカ



概要

ダウは2026年第2四半期決算で純利益8億200万ドルを計上し、前年同期の損失から大幅な黒字転換を果たしました。売上高は前年比20%増の120.9億ドルに達し、主にパッケージング&スペシャルティプラスチック部門におけるポリエチレン価格の上昇と堅調な需要が牽引しました。同社は「Transform to Outperform」プログラムを通じたコスト削減と生産性向上により、年間13億ドル以上の利益創出を目指しており、市場予想を上回る業績となりました。

主要成果

ダウは2026年第2四半期において、純利益8億200万ドルを達成し、前年同期の純損失から黒字転換しました。調整後利益はウォール街の予想を上回り、統合EBITは前年比12億ドル増の13億ドルに達しました。この好調な業績は、主にポリエチレン価格の上昇と、同社の広範なコスト削減・生産性向上プログラム「Transform to Outperform」が寄与しています。

技術・事業詳細

- **パッケージング&スペシャルティプラスチック部門の好調:** この部門の売上高は前年比27%増の64億ドルとなり、堅調なポリエチレン価格が収益を押し上げました。柔軟なパッケージング用途における需要が特に貢献しています。
- **「Transform to Outperform」プログラム:** ダウは、このプログラムを通じて年間13億ドル以上の利益創出を目指しており、その効果が今回の四半期決算に顕著に現れています。具体的には、ポートフォリオ最適化と事業プロセスの効率化が進行中です。
- **シリコン製品の貢献:** ダウのシリコン製品は、パッケージング、インフラ、モビリティ、および消費者アプリケーション市場において幅広く貢献しており、同社の多様な製品ポートフォリオが業績を支える要因となっています。

背景・業界文脈

2026年第2四半期は、中東紛争による供給ショックが原油価格とそれに伴う化学製品価格に影響を与え、ポリエチレン市場価格が上昇しました。このような外部環境の変化に加え、ダウの戦略的な事業構造改革と効率化努力が奏功し、マージン改善に繋がりました。サプライチェーンの強靱化と市場変動への対応力が今回の好業績の背景にあります。

今後の展望

ダウは今後も「Transform to Outperform」プログラムを推進し、持続的な利益成長を目指します。特に、高付加価値の特殊化学品および材料分野への注力を継続し、市場の需要に応じた製品ポートフォリオの最適化を図る方針です。シリコンなどの成長分野への投資も継続し、モビリティ、エレクトロニクス、医療技術といった戦略的市場での競争優位性を強化することで、長期的な企業価値向上を目指します。

元記事: <https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-reports-second-quarter-2026-results.html>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#02 Durante Adesivi、Advatac買収により英国木工用接着剤製造拠点を拡大し欧州市場を強化

公開日 2026年07月17日 SpecialChem イタリア



概要

Durante Adesiviは、英国の木工用PVAcおよびポリウレタン分散液（PUD）接着剤メーカーであるAdvatac Ltd.を買収しました。この買収により、Durante AdesiviはAdvatacの現地製造専門知識と自社のホットメルト接着剤および工業用接着剤の国際的な製品範囲を統合します。これにより、欧州全域の顧客へのサポート体制を強化し、Soudal Groupとしての接着剤市場におけるプレゼンスを拡大します。

主要成果

イタリアの接着剤メーカーであるDurante Adesiviは、英国の木工用接着剤メーカー Advatac Ltd.の買収を完了しました。この戦略的動きにより、Durante Adesiviは英国での製造拠点を拡大し、木工用ポリ酢酸ビニル（PVAc）およびポリウレタン分散液（PUD）接着剤の生産能力を強化します。今回の統合は、欧州市場における Durante Adesivi の顧客サービスと製品供給能力を飛躍的に向上させると期待されています。

技術・事業詳細

- **製品ポートフォリオの拡大:** Durante Adesivi は、Advatac の専門知識を取り入れることで、既存のホットメルトおよび工業用接着剤の幅広い国際的な製品範囲に、英国で現地製造されるPVAcおよびPUD木工用接着剤を加えることができます。
- **製造能力の強化:** Advatac が持つ英国での製造専門知識は、Durante Adesivi の生産体制を補完し、欧州市場への迅速かつ効率的な製品供給を可能にします。これにより、地域特有の需要に合わせたカスタマイズも容易になります。
- **Soudal Groupとのシナジー:** Durante Adesivi は Soudal Group に属しており、今回の買収はグループ全体の接着剤事業戦略の一環です。Soudal Group の広範な国際組織を活用し、より強力な市場展開が期待されます。

背景・業界文脈

木工用接着剤市場は、家具製造、建築、フローリングなど多様な分野で需要が拡大しています。特に、環境規制の厳格化に伴い、低VOC（揮発性有機化合物）で高性能な接着剤へのニーズが高まっており、PVAcやPUD接着剤はその要求を満たす主要なソリューションです。Durante Adesiviは、今回の買収を通じて、英国および欧州市場におけるこの需要増に対応し、競争力を強化することを目指しています。

今後の展望

Durante Adesiviは、Advatacの統合により、欧州全域でより包括的な接着剤ソリューションを提供できるようになります。この拡大された製造能力と製品ラインナップは、新規顧客の獲得と既存顧客への付加価値提供に貢献し、同社の市場シェア拡大を加速させるでしょう。また、Soudal Groupの一員として、研究開発リソースを活用し、次世代の持続可能な接着剤技術の開発にも注力していく方針です。

元記事: <https://www.specialchem.com/adhesives/news/durante-adesivi-expands-uk-manufacturing-footprint-for-woodworking-adhesives-with-advatac-acquisition>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#03 ダウ、約1億ドル投資し米国・中国・日本で特殊シリコン生産能力を世界的に拡大

公開日 2026年07月19日 K Trade Fair アメリカ



概要

ダウは、米国、中国、日本の各拠点に約1億ドルを投資し、特殊シリコンの生産および加工能力を世界的に拡大すると発表しました。この投資は、特にモビリティ、エレクトロニクス、医療技術分野の需要に対応するため、液状シリコンゴム（LSR）やエンジニアリングシリコン材料の能力を増強します。これにより、高成長市場における顧客ニーズへの対応力とサプライチェーンの安定性が強化されます。

主要成果

ダウは、特殊シリコーンの生産・加工能力をグローバルに拡大するため、約1億ドルの戦略的投資を発表しました。この大規模な投資は、米国、中国、日本の主要製造拠点に集中しており、高成長を続けるモビリティ、エレクトロニクス、医療技術市場における需要増に対応することを目的としています。

技術・事業詳細

- **対象分野と製品:** 投資の大部分は、液状シリコーンゴム（LSR）とエンジニアリングシリコーン材料の能力増強に充てられます。LSRは精密な成形が可能で、自動車、医療機器、家電製品などで急速に採用が進んでいます。エンジニアリングシリコーン材料は、その優れた耐久性と熱安定性から、エレクトロニクスや産業用途で不可欠な部品となっています。
- **地域的な重点:** 主要な生産拠点である米国、中国、日本での能力増強は、各地域の市場特性と需要に対応したものです。特にアジア市場はエレクトロニクスとモビリティ分野での成長が著しく、この投資は地域の顧客への供給体制を強化します。
- **投資額:** 約1億ドルという投資額は、ダウが特殊シリコーン分野を戦略的成長ドライバーと位置づけていることを示しており、長期的な市場リーダーシップの維持を目指す姿勢が明確です。

背景・業界文脈

今日の高機能製品は、小型化、高性能化、そして高い信頼性が求められており、その実現には先進的な特殊シリコーン材料が不可欠です。電気自動車（EV）の普及、5G通信技術の進展、そして高度な医療機器の需要増は、シリコーン市場の力強い成長を牽引しています。ダウの今回の投資は、これらのメガトレンドに対応し、サプライチェーンの強靭化と市場シェアの拡大を図るためのものです。

今後の展望

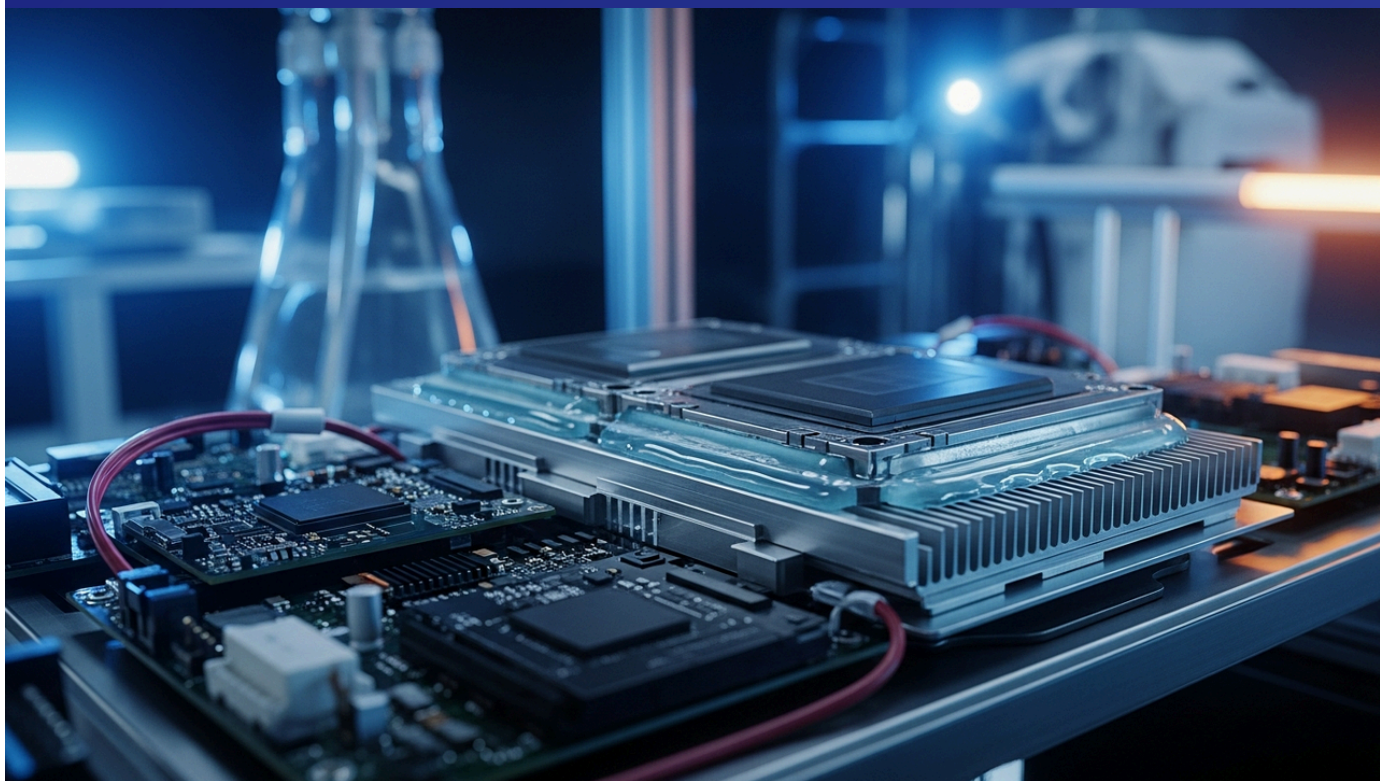
今回の生産能力拡大により、ダウは特殊シリコン製品の供給安定性を高め、顧客への迅速な対応を可能にします。これにより、モビリティ分野におけるバッテリーパック用シーリング材やセンシングデバイス、エレクトロニクス分野における熱管理材料や保護コーティング、医療分野における移植可能デバイスや薬物送達システムなど、多岐にわたる高付加価値アプリケーションでのダウの存在感が一層強化されるでしょう。この投資は、ダウの持続可能な成長戦略の中核をなすものです。

元記事: https://www.k-online.com/en/Media_News/News/Industry_News/Dow_Expansion_of_Silicone_Capacity

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#04 ヘンケル、EV・ADAS向け高熱伝導率6.5W/m・Kの次世代熱ギャップフィラー「Bergquist Gap Filler TGF 6500LVO」を発表

公開日 2026年07月22日 EuropaWire (PRESS RELEASE) ドイツ



概要

ヘンケル・アドヒーズブ・テクノロジーズは、熱伝導率6.5W/m・Kを誇る次世代熱ギャップフィラー「Bergquist Gap Filler TGF 6500LVO」を発売しました。この2成分シリコーンベースの材料は、電気自動車（EV）、先進運転支援システム（ADAS）、および電子制御ユニット（ECU）などの高電力密度アプリケーションにおける熱管理を大幅に改善します。これにより、高まる熱負荷に対応し、電子コンポーネントの信頼性と寿命向上に貢献します。

主要成果

ヘンケル・アドヒーズブ・テクノロジーズは、自動車エレクトロニクスの厳しさを増す熱管理需要に対応するため、革新的な次世代熱ギャップフィラー「Bergquist Gap Filler TGF 6500LVO」を発表しました。この新製品は、 $6.5\text{W/m}\cdot\text{K}$ という高い熱伝導率を特徴とし、電気自動車（EV）、先進運転支援システム（ADAS）、および電子制御ユニット（ECU）内の電力変換コンポーネントなどの先進アプリケーションにおける高熱負荷に対応します。

技術・臨床詳細

- **優れた熱伝導性:** Bergquist Gap Filler TGF 6500LVOは、市場をリードする $6.5\text{W/m}\cdot\text{K}$ の熱伝導率を提供し、熱源からヒートシンクへの効率的な熱伝達を可能にします。これにより、電子部品の過熱を防ぎ、性能の安定化と信頼性の向上に寄与します。
- **2成分シリコンベース:** この材料は2成分シリコンベースであり、硬化後の優れた柔軟性と信頼性を提供します。低いボンドライン厚さ（BLT）での使用が可能で、複雑な形状や狭いギャップにも容易に適用でき、優れた密着性を発揮します。
- **高まる電力密度への対応:** ADASセンサー、EVのパワーエレクトロニクス、ECUといった現代の自動車エレクトロニクスは、ますます小型化・高機能化が進み、それに伴い電力密度と発熱量が増大しています。本製品は、これらの課題を解決するための最適なソリューションとして設計されています。

背景・業界文脈

自動車産業は電動化と自動運転技術の進化により、車載エレクトロニクスへの依存度を急速に高めています。これにより、バッテリー、モーター、インバーター、ECUなどの主要コンポーネントから発生する熱を効率的に管理することが、車両の安全性、性能、そして寿命を左右する極めて重要な要素となっています。従来の熱管理材料では対応が困難になりつつある中、ヘンケルのような革新的な材料が求められています。

今後の展望

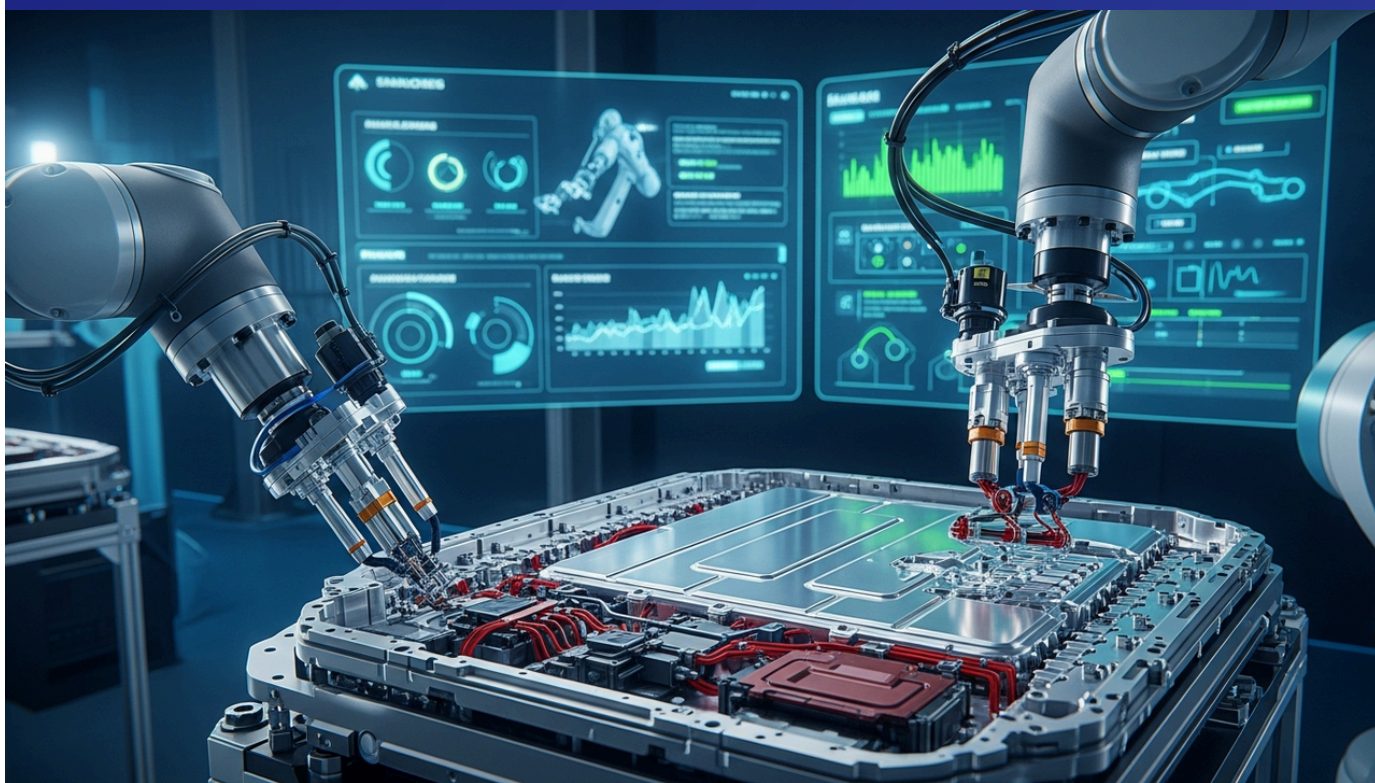
Bergquist Gap Filler TGF 6500LVOの導入は、ヘンケルの自動車エレクトロニクス市場におけるリーダーシップをさらに強化するものです。この新技術は、EV航続距離の延長、ADASシステムの精度向上、そして車載電子システムの全体的な信頼性向上に直接貢献します。今後、さらなる高熱伝導率と多様な適用性を持つ熱管理材料の開発が進み、自動車業界の次なる技術革新を支える基盤となることが期待されます。

元記事: <https://news.europawire.eu/henkel-launches-bergquist-gap-filler-tgf-6500lvo-for-automotive-electronics-thermal-management/eu-press-release/2026/07/22/14/55/33/178336/?amp>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#05 Transpire Insightが金属接合用接着剤市場を分析、ヘンケルはEVバッテリー向けAIシミュレーションで革新を推進

公開日 2026年07月23日 Transpire Insight アメリカ



概要

Transpire Insightの調査レポートは、金属接合用接着剤市場が2026年の88億ドルから2035年には134億ドルに成長すると予測しています。この市場成長は、自動車および航空宇宙産業における構造軽量化や電気自動車（EV）バッテリー生産の急速な増加によって牽引されています。ヘンケルは2026年5月にBattery Show EuropeでAI駆動の「Loctite Solve」デジタルツインシミュレーションプラットフォームを発表し、軽量EVバッテリーシステムの開発加速を目指しています。

主要成果

Transpire Insightの最新調査によると、金属接合用接着剤市場は2026年の88億ドルから2035年には134億ドルへと力強く成長すると予測されています。この成長は、自動車や航空宇宙分野における軽量化の推進と、電気自動車（EV）バッテリー生産の急増が主な要因です。特に、ヘンケルはEVバッテリー開発においてAIを活用した画期的なソリューションを導入しています。

技術・事業詳細

- **市場成長の牽引要因:** 自動車産業では、燃費効率の向上と排出ガス削減のために軽量素材へのシフトが進んでおり、金属接合用接着剤はその重要な要素です。航空宇宙産業でも同様に、機体軽量化による性能向上と運用コスト削減が重視されています。また、EVバッテリーパックの構造接着にも高性能接着剤が不可欠です。
- **ヘンケルのAI駆動ソリューション:** ヘンケルは2026年5月にBattery Show Europeで「Loctite Solve」デジタルツインシミュレーションプラットフォームを発表しました。このプラットフォームはAIを活用し、接着剤の選定、塗布プロセス、および性能予測を最適化することで、軽量EVバッテリーシステムの開発サイクルを大幅に短縮します。これにより、設計の反復回数を減らし、市場投入までの時間を短縮することが可能です。
- **Loctite Solveの利点:** このデジタルツインシミュレーションは、物理的な試作なしに様々な接着シナリオをテストできるため、開発コストと時間を削減します。特に複雑なEVバッテリー構造における熱管理、振動吸収、および長期信頼性に関する課題解決に貢献します。

背景・業界文脈

近年、製造業では持続可能性と効率性の両立が求められており、特に自動車分野では電動化の進展が接着技術の革新を強く推進しています。金属接合用接着剤は、従来の溶接やリベット接合に比べて、軽量化、応力分散、疲労特性の向上、異種材料接合の実現といった多くの利点を提供します。ヘンケルのようなリーディングカンパニーがAI技術を接着剤開発に統合することで、この分野は新たな局面を迎えています。

今後の展望

金属接合用接着剤市場は、EVおよび航空宇宙産業の継続的な成長により、今後も拡大が続くでしょう。AIとシミュレーション技術の導入は、接着剤の性能最適化だけでなく、設計から製造までのプロセス全体を革新する可能性を秘めています。ヘンケルの「Loctite Solve」のようなツールは、エンジニアがより迅速かつ正確に最適な接着ソリューションを見つけることを可能にし、高機能かつ軽量の次世代製品の開発を加速させる重要な役割を果たすと期待されます。これにより、製品の安全性と信頼性も向上し、産業全体の競争力強化に貢献します。

元記事: <https://www.transpireinsight.com/blogdetails/global-top-25-metal-bonding-adhesives-companies>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#06 3Mが主導するエポキシ構造接着剤の特許動向、自動車・航空宇宙の軽量化で多材料接着が鍵

公開日 2026年07月22日 Patsnap アメリカ



概要

Patsnapの分析によると、エポキシ構造接着剤の特許分野は成熟期にあり、3M Innovative Properties Coが特許ポートフォリオを主導しています。自動車の軽量化や航空宇宙組立用途での多材料接着（B32B）の需要は増加しているにもかかわらず、関連特許出願の割合は相対的に低い水準にとどまっています。この傾向は、特にエレクトロニクス用途において、DowとIBMの共同出願が今後の革新の方向性を示唆しています。

主要成果

Patsnapの最新分析により、エポキシ構造接着剤の特許分野は成熟段階に達しており、3M Innovative Properties Coがこの技術領域における特許ポートフォリオの大部分を保有し、イノベーションを主導していることが明らかになりました。注目すべきは、自動車や航空宇宙産業における軽量化推進に伴う多材料接着（B32B）の需要増にもかかわらず、関連する特許出願の割合が現状では低いことです。

技術・事業詳細

- **3Mの優位性:** 3M Innovative Properties Coは、エポキシ構造接着剤の分野で強力な知的財産基盤を築いており、その技術は多様な産業応用を可能にしています。これには、高い強度、耐久性、耐環境性といったエポキシ接着剤の特性を最大限に引き出すための改良が含まれます。
- **多材料接着の課題と機会:** 自動車の燃費向上や電気自動車（EV）の軽量化、航空宇宙機の性能向上には、スチール、アルミニウム、複合材料など異種材料を効率的かつ堅牢に接合する技術が不可欠です。しかし、異なる熱膨張係数や表面特性を持つ材料間の強固な接着を実現するには技術的な課題が多く、今後の特許活動の大きな機会となる可能性があります。
- **DowとIBMの協業:** DowとIBMによる共同特許出願は、エポキシ構造接着剤がエレクトロニクス分野においても重要な役割を果たすことを示唆しています。特に、半導体パッケージングや高密度回路基板における接着・封止材としての応用が期待されます。

背景・業界文脈

エポキシ構造接着剤は、その優れた機械的強度、耐熱性、耐薬品性から、自動車、航空宇宙、建設、エレクトロニクスなど幅広い産業で利用されています。特に、自動車のCO2排出量削減目標や航空機の燃費効率向上目標達成には、金属部品の溶接・機械的接合から接着剤への移行が不可欠です。しかし、これらの用途で求められる高い信頼性と耐久性を保証するためには、継続的な材料科学の革新と知的財産保護が重要となります。

今後の展望

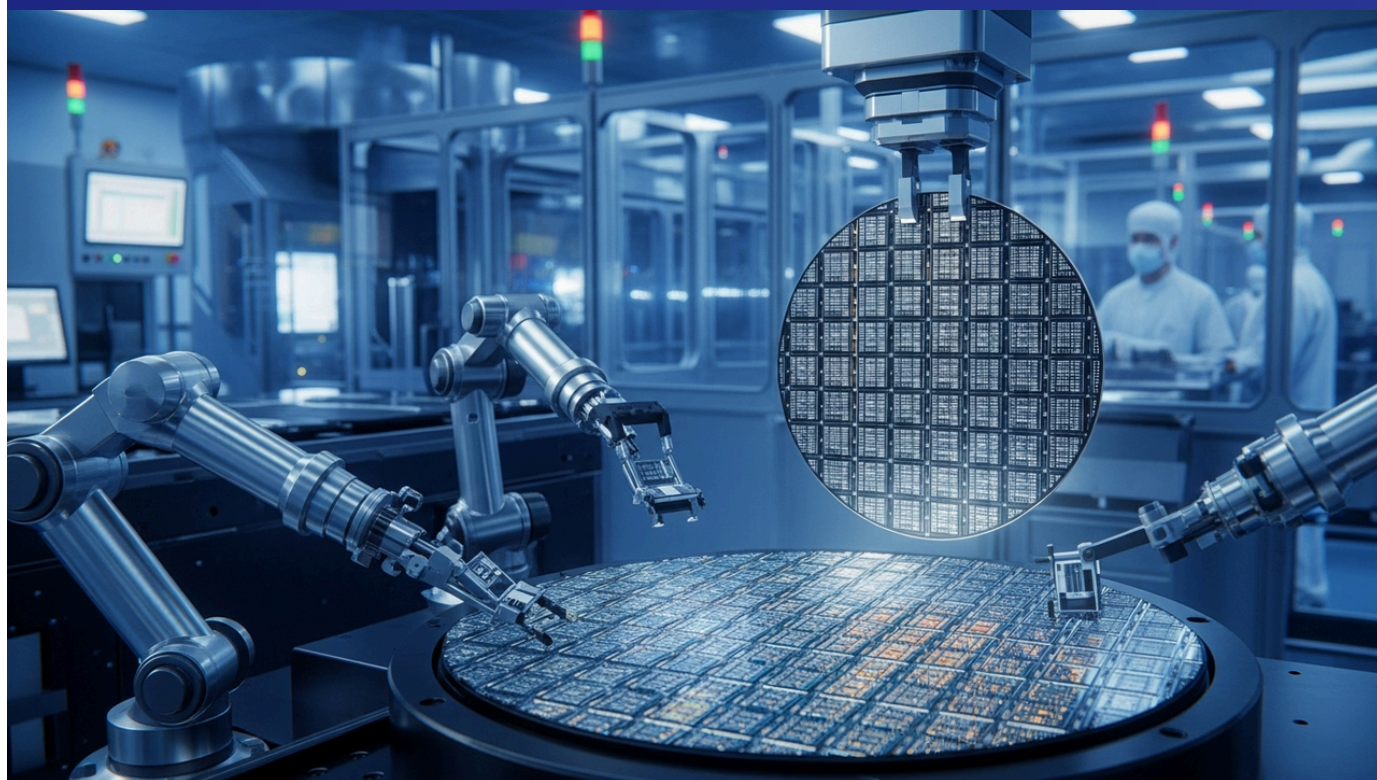
エポキシ構造接着剤の特許分野は成熟しているものの、多材料接着やエレクトロニクス分野などの特定のニッチ市場では、いまだ大きな成長機会が残されています。特に、AIやマテリアルズインフォマティクスを活用した新しい接着剤組成物の設計や、プロセス技術の最適化に関する特許出願が増加する可能性があります。DowとIBMのような大手企業間の協力は、新たな技術ブレークスルーを生み出し、エポキシ接着剤の適用範囲をさらに拡大させることで、自動車やエレクトロニクス産業の次世代製品開発を加速させるでしょう。

元記事: <https://www.patsnap.com/resources/blog/rd-blog/epoxy-structural-adhesive-patent-landscape/>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#07 ウェハーレベルパッケージング市場、2035年には288.1億ドルに成長予測：チップ小型化と熱効率向上を牽引

公開日 2026年07月16日 (市場調査) 不明



概要

本記事は、ウェハーレベルパッケージング市場に関する市場調査レポートの概要紹介です。チップの小型化、電氣的性能向上、熱効率改善への要求が、2026年の119.7億ドルから2035年には288.1億ドルへの市場成長を牽引すると予測されています。ファンインおよびファンアウトWLPといった先進パッケージング技術の採用が加速しており、アンダーフィル、モールドコンパウンド、誘電体材料、TSVなどの材料が重要な役割を果たすと分析されています。

詳細

本記事は、市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

- **調査対象市場:** ウェハーレベルパッケージング市場（Wafer Level Packaging Market）
- **対象地域:** グローバル
- **調査期間:** 2026年～2035年（予測）
- **発行会社:** 不明（市場調査）

主要な調査結果

ウェハーレベルパッケージング（WLP）市場は、2026年の119.7億ドルから2035年には288.1億ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は未公開ですが、大幅な成長が見込まれています。この市場成長の主要な牽引役は、より小型で、電氣的性能が高く、熱効率が優れたチップに対する要求の増加です。WLP技術は、従来のパッケージング手法と比較して、フットプリントの削減と性能の最適化を実現します。

ファンインWLP（FIWLP）やファンアウトWLP（FOWLP）といった先進パッケージング技術の採用が急速に進んでいます。これらの技術は、モバイルデバイス、ウェアラブル、IoTデバイスなど、小型化と高性能化が不可欠なアプリケーションで特に重要です。

WLPプロセスにおいて使用される主要な材料には、アンダーフィル、モールドコンパウンド、誘電体材料、およびTSV（Through Silicon Via）関連材料などが含まれます。これらの材料は、パッケージの信頼性、熱管理、電氣的接続において決定的な役割を果たします。

発行会社について

市場調査会社が発行したレポートの概要です。提供元は明記されていませんが、このようなレポートは通常、市場規模予測、成長ドライバー、主要プレイヤー、地域分析など、詳細な市場情報を提供しています。

元記事: <https://www.towardspackaging.com/insights/wafer-level-packaging-market-sizing>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#08 APPLIED AdhesivesがIndustrial Sales and Distribution買収、シリコンソリューションと米国東海岸のプレゼンスを拡大

公開日 2026年07月19日 Specialty Adhesives and Sealants (AdhesivesMag.com) アメリカ



概要

APPLIED Adhesivesは、接着剤とシリコンの販売代理店であるIndustrial Sales and Distribution Inc. (ISD) を買収しました。この買収により、APPLIED Adhesivesは接着剤とシリコン市場での地位を強化し、航空宇宙、製品組立、パッド印刷市場の顧客に対して、より広範な製品ポートフォリオと技術的専門知識を提供できるようになります。特に、米国東海岸における同社の地理的プレゼンスが拡大し、顧客サポート体制が強化されます。

主要成果

APPLIED Adhesives は、接着剤およびシリコン製品の有力な販売代理店である Industrial Sales and Distribution Inc. (ISD) を買収しました。この戦略的な買収は、APPLIED Adhesivesの接着剤およびシリコン市場における事業基盤を大幅に強化し、特に米国東海岸地域における同社の地理的プレゼンスを拡大します。

技術・事業詳細

- **製品ポートフォリオの強化:** ISDの買収により、APPLIED Adhesivesは、接着剤、シーリング材、潤滑剤、コーティング剤など、シリコンベースのソリューションを含む製品ポートフォリオをさらに充実させることができます。これにより、顧客はより幅広い選択肢と多様なアプリケーションに対応する製品を入手できるようになります。
- **技術的専門知識の統合:** ISDが長年にわたり培ってきた販売および技術サポートの専門知識は、APPLIED Adhesivesの既存のリソースと統合され、航空宇宙、製品組立、パッド印刷といった特殊市場の顧客に対して、より高度な技術的ソリューションとサポートを提供可能になります。
- **東海岸市場への浸透:** 米国東海岸地域におけるISDの強力なネットワークと顧客基盤を取り込むことで、APPLIED Adhesivesは未開拓だった市場へのアクセスを獲得し、新たな成長機会を創出します。これにより、地域全体の顧客へのサービス提供能力が向上します。

背景・業界文脈

接着剤およびシーリング材市場は、高機能材料への需要増加、サプライチェーンの効率化、および地域市場での迅速な対応能力が求められる中で成長を続けています。特に、航空宇宙産業では、軽量化と耐久性の両立が求められ、高品質な接着剤とシリコンソリューションが不可欠です。また、エレクトロニクスや一般産業においても、特殊な接着・封止ニーズが増加しており、専門知識を持つ販売代理店の役割が重要視されています。

今後の展望

今回の買収は、APPLIED Adhesivesが接着剤およびシリコン市場における競争力をさらに高め、戦略的成長を加速させるための重要なステップです。統合された事業は、顧客に対してより包括的な製品、専門的な技術サポート、および迅速なサービスを提供することで、長期的な顧客関係の構築と市場シェアの拡大を目指します。今後、特に高成長が見込まれる特殊市場において、新技術の導入やソリューション提供を通じて、継続的なイノベーションを推進していく方針です。

元記事: <https://www.adhesivesmag.com/articles/102531-applied-adhesives-expands-silicone-solutions-and-east-coast-presence-with-acquisition>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#09 Kansai Nerolac、イタリアのDurante Adesiviと提携 しインド接着剤市場でNerofixのプレゼンスを強化

公開日 2026年07月17日 Indian Chemical News インド



概要

Kansai Nerolac Paintsの子会社であるNerofix Private Limitedは、イタリアの Durante Adesivi S.p.A.と戦略的パートナーシップを締結しました。この提携は、 Durante Adesivi のホットメルト接着剤技術の専門知識と Nerofix のインド市場での広範なリーチを組み合わせることで、インドの接着剤エコシステムにおける Kansai Nerolac のプレゼンスを強化することを目的としています。特に木工およびパッケージング分野での市場拡大が期待されます。

主要成果

Kansai Nerolac Paintsの子会社であるNerofix Private Limitedは、イタリアの Durante Adesivi S.p.A.との間で戦略的パートナーシップを締結しました。この提携は、インドの接着剤市場におけるKansai Nerolacの事業拡大を加速させる重要な一歩であり、特にホットメルト接着剤技術分野での競争力強化を目指します。

技術・事業詳細

- **Durante Adesivi の技術力:** Durante Adesivi は、ホットメルト接着剤技術における長年の専門知識と革新的な製品開発で知られています。今回の提携により、その高度な技術がインド市場に導入され、Nerofixの製品ポートフォリオを強化します。
- **Nerofix の市場リーチ:** Nerofix は、インド国内で広範な販売ネットワークと強力な市場プレゼンスを確立しています。Durante Adesivi の技術をNerofixの流通チャネルを通じて提供することで、インド全土の顧客に対して高品質な接着剤ソリューションを供給できるようになります。
- **戦略的シナジー:** このパートナーシップは、Durante Adesivi の技術革新力と Nerofix の市場浸透力を組み合わせることで、特に木工、家具製造、パッケージングといった成長分野において、新たなビジネス機会を創出します。これにより、両社は相乗効果を発揮し、市場シェアの拡大を目指します。

背景・業界文脈

インドの接着剤市場は、建設、自動車、パッケージング、家具製造などの主要産業の成長を背景に、急速な拡大を続けています。特に、環境に配慮した高性能接着剤や、生産効率を向上させるホットメルト接着剤への需要が高まっています。国際的な技術を持つ Durante Adesiviと、強力な国内市場基盤を持つNerofixの提携は、この需要に対応するための理想的な戦略です。

今後の展望

今回の戦略的パートナーシップにより、Kansai Nerolacはインドの接着剤市場におけるリーダーシップを強化し、高成長が見込まれる分野での事業拡大を図ります。ホットメルト接着剤は、その速乾性、汎用性、およびVOC排出量の低さから、製造業でますます採用が進んでおり、この提携はインド市場における同技術の普及を加速させるでしょう。両社の協力は、顧客への提供価値を高めるとともに、インド経済の発展にも貢献することが期待されます。

元記事: <https://www.indianchemicalnews.com/chemical/kansai-nerolac-expands-adhesives-play-with-strategic-partnership-between-nerofix-and-italys-durante-adesivi-31149>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#10 感圧接着剤市場、アクリル樹脂が支配し環境対応製品開発を加速、DowとHenkelが排出量削減で連携

公開日 2026年07月18日 Credence Research アメリカ



概要

本記事は、感圧接着剤（PSA）市場に関する市場調査レポートの概要紹介です。PSA市場は3M、Henkel AG、Avery Dennisonなどの主要企業によって牽引されており、アクリル樹脂が最大のシェアを占め、水性システムとの互換性により環境に優しい製造と低VOC製品開発をサポートしています。Dow Inc.とHenkel AG & Co. KGaAは、2025年10月に接着剤ポートフォリオ全体で排出量を削減するための戦略的パートナーシップを拡大しました。

詳細

本記事は、Credence Researchが発行した市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

- **調査対象市場:** 感圧接着剤（PSA）市場（Pressure Sensitive Adhesives Market）
- **対象地域:** グローバル
- **調査期間:** 複数年（詳細不明、発表日より過去および将来予測を含む）
- **発行会社:** Credence Research

主要な調査結果

感圧接着剤（PSA）市場は、3M Company、Henkel AG & Co. KGaA、Avery Dennison Corporationなどの主要企業によって力強く牽引されています。これらの企業は、製品イノベーションと市場拡大において重要な役割を果たしています。

- **アクリル樹脂の支配:** アクリル樹脂は、PSA市場において最大のシェアを占める材料タイプです。その優れた接着特性、耐候性、および多用途性から、テープ、ラベル、医療用パッチなど幅広いアプリケーションで利用されています。
- **環境対応と低VOC:** アクリル樹脂系PSAは、水性システムとの互換性が高く、環境に優しい製造プロセスを可能にします。これにより、揮発性有機化合物（VOC）排出量を低減した製品の開発が加速しており、環境規制が厳しくなる中でその重要性が増しています。
- **DowとHenkelの戦略的連携:** Dow Inc.とHenkel AG & Co. KGaAは、持続可能性へのコミットメントを強化するため、2025年10月に接着剤ポートフォリオ全体で排出量を削減するための戦略的パートナーシップを拡大しました。この提携は、環境負荷の低い接着剤ソリューションの開発を促進し、業界全体の持続可能性向上に貢献します。

発行会社について

Credence Researchは、グローバル市場における様々な産業セクターの市場調査レポートを提供する独立系調査会社です。同社のレポートは、市場規模、成長トレンド、競合分析、セグメント別分析、将来予測といった情報を提供し、企業の戦略策定を支援します。

元記事: <https://www.credenceresearch.com/report/pressure-sensitive-adhesive-market>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#11 Sheen Technology、EV・AIハードウェア向け「打ち抜き可能なシリコーンフリー熱伝導材料」の選定ガイドを公開

公開日 2026年07月23日 Sheen Technology 不明



概要

Sheen Technologyは、高容量エレクトロニクス製造向けの「打ち抜き可能なシリコーンフリー熱伝導材料」の選択方法に関するガイドを公開しました。この材料は、電気自動車（EV）やAIハードウェアにおける熱界面材料（TIM）の採用加速に伴い、シリコーンのアウトガス、移動、およびコスト要件を回避する代替バインダーシステムとして重要性を増しています。特に、高電力密度環境での信頼性と性能維持に貢献します。

主要成果

Sheen Technologyは、高容量エレクトロニクス製造において不可欠な「打ち抜き可能なシリコンフリー熱伝導材料（Silicone-Free Thermal Conductive Material）」の最適な選択方法に関する詳細なガイドを発表しました。この革新的な材料は、電気自動車（EV）や人工知能（AI）ハードウェアなどの高電力密度アプリケーションにおいて、熱管理の課題を解決する上で重要な選択肢として浮上しています。

技術・事業詳細

- **シリコンフリーの利点:** 従来のシリコンベースの熱界面材料（TIM）は、アウトガスやコンポーネントへのシリコン移動といった問題を引き起こす可能性があります。これらは、特に光学部品や敏感な電子部品に影響を与え、製品の信頼性を損なう恐れがあります。シリコンフリー材料は、これらのリスクを排除し、よりクリーンで安定した動作環境を提供します。
- **打ち抜き可能な特性:** 製造プロセスにおいて、熱伝導材料は様々な形状に加工される必要があります。打ち抜き可能な特性は、精密な加工と大量生産の効率性を大幅に向上させ、製造コストの削減にも寄与します。
- **高電力密度アプリケーションへの対応:** EVバッテリーパック、モーターコントローラー、AIプロセッサ、高性能データセンターのGPUなど、現代の高容量エレクトロニクスは膨大な熱を発生させます。シリコンフリー熱伝導材料は、優れた熱伝導性を持ちながら、上記のシリコン問題を起こさないため、これらのシステムの効率的な冷却と長期信頼性維持に不可欠です。
- **代替バインダーシステム:** シリコンに代わるバインダーシステムを採用することで、材料の選択肢が広がり、特定のアプリケーション要件（例：特定の耐薬品性、機械的特性）に合わせたカスタマイズが可能になります。

背景・業界文脈

電気自動車の普及とAI技術の進化は、半導体とエレクトロニクス業界に前例のない熱管理の課題をもたらしています。小型化と高性能化が同時に進む中で、発生する熱を効率的に放散することが、デバイスの性能維持と寿命延長の鍵となります。このような背景から、シリコンフリーの高性能熱伝導材料への需要が急増しています。

今後の展望

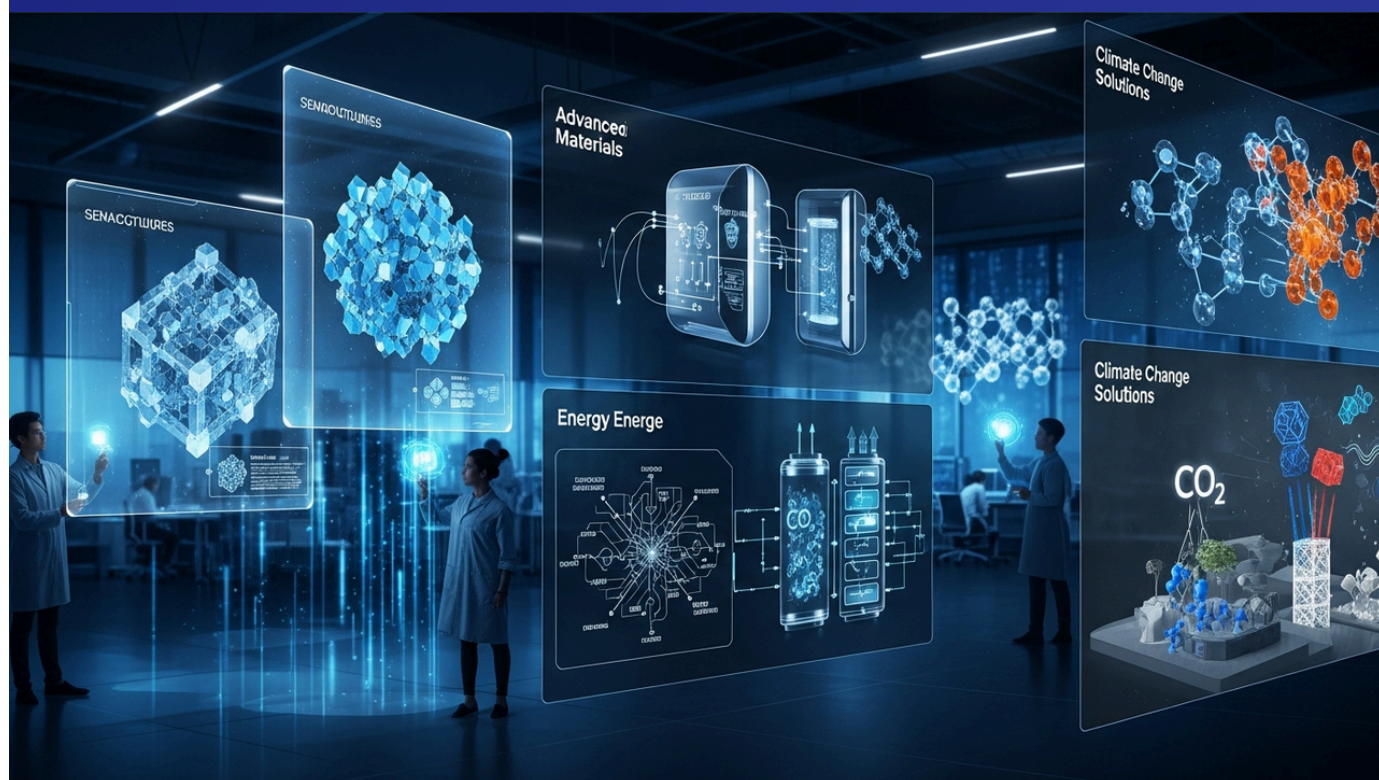
Sheen Technologyが提供する「打ち抜き可能なシリコンフリー熱伝導材料」は、EVおよびAIハードウェア市場における熱管理ソリューションの新たな標準を確立する可能性を秘めています。この材料は、製造プロセスを簡素化し、製品の信頼性を向上させることで、次世代エレクトロニクス製品の設計と生産に大きな影響を与えるでしょう。今後、さらなる高熱伝導性、環境適合性、およびコスト効率に優れたシリコンフリー材料の開発が期待され、持続可能なエレクトロニクス産業の発展に貢献します。

元記事: <https://www.sheenthermal.com/how-to-select-punchable-silicone-free-thermal-conductive-material.html>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#12 CuspAI、「AI Materials Foundry」を立ち上げ、レゾナック含む45超のパートナーと半導体・エネルギー・気候変動の材料発見を加速

公開日 2026年07月20日 Morningstar (Business Wire) イギリス



概要

CuspAIは、半導体、エネルギー、気候変動分野での画期的な材料発見を加速するため、グローバルネットワーク「AI Materials Foundry」を立ち上げました。レゾナック・ホールディングスが創設メンバーとしてこの取り組みに参加しており、AIが先進材料の発見と開発を変革する可能性に期待を寄せています。このネットワークにはNVIDIAやMetaを含む45以上のパートナーが参画し、AI駆動型の科学的発見を通じて産業界の課題解決を目指します。

主要成果

ケンブリッジ大学発のディープテック企業CuspAIは、半導体、エネルギー、気候変動といった重要分野における画期的な材料発見を加速するためのグローバルネットワーク「AI Materials Foundry」を正式に立ち上げました。このイニシアチブは、人工知能（AI）を活用して新材料の設計と開発プロセスを劇的に短縮することを目指しており、レゾナック・ホールディングスがその創設メンバーとして参画しています。

技術・事業詳細

- **AI Materials Foundryの目的:** このネットワークは、AI駆動型のシミュレーションとデータ分析を通じて、従来の実験ベースのアプローチよりもはるかに迅速に、特定の性能要件を満たす新材料を特定・最適化することを目的としています。これにより、材料開発のボトルネックを解消し、イノベーションのペースを加速させます。
- **レゾナックの役割:** 半導体材料や高機能化学品分野で世界をリードするレゾナックは、創設メンバーとして、その深い材料科学の専門知識と製造ノウハウを「AI Materials Foundry」に提供します。特に、AIを活用した新しい半導体パッケージング材料や熱管理材料の探索が期待されます。
- **広範なパートナーシップ:** 「AI Materials Foundry」には、NVIDIA、Metaなど、AI、半導体、材料科学の分野を代表する45以上の企業や研究機関がパートナーとして参加しています。この多様なエコシステムが、共同研究、データ共有、技術移転を促進し、複合的な課題解決を可能にします。

背景・業界文脈

新材料の発見と開発は、歴史的に時間とコストがかかるプロセスであり、多くの産業における技術革新の制約となってきました。しかし、近年、AIと計算科学の進歩により、このプロセスを根本的に変革する可能性が生まれています。特に、半導体の微細化限界、クリーンエネルギー技術の効率向上、CO2排出量削減のための革新的な材料が緊急に求められており、AIの活用はこれらの課題解決に不可欠とされています。

今後の展望

「AI Materials Foundry」の立ち上げは、AIが材料科学研究に与える影響の大きさを象徴するものです。レゾナックを含む参加企業は、このプラットフォームを通じて、次世代半導体、高効率エネルギー貯蔵デバイス、炭素回収技術などの開発を加速することが期待されます。共同研究と知識の共有により、各産業分野における材料のパフォーマンスと持続可能性が向上し、グローバルな技術革新と環境課題解決への貢献が期待されます。このネットワークは、今後、材料科学のフロンティアを再定義する可能性を秘めています。

元記事: <https://www.morningstar.com/news/business-wire/20260716196996/cuspai-launches-ai-materials-foundry-a-global-network-to-accelerate-breakthrough-discoveries>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#13 H.B. FullerがAdvanced Medical Solutionsを約6.6億ポンドで買収、医療接着剤技術を強化

公開日 2026年07月20日 Perivan アメリカ



概要

H.B. Fullerは、革新的な組織治癒技術の開発・製造を行う英国のAdvanced Medical Solutions Group plc (AMS) を約6億6000万ポンド（約1280億円）で買収すると発表しました。AMSは、LiquiBand®ブランドの組織接着剤、縫合糸、止血剤など、幅広い外科用製品を提供しています。この買収により、H.B. Fullerは医療接着剤技術分野における製品ポートフォリオとグローバルなプレゼンスを大幅に強化し、高成長の医療市場におけるリーダーシップを確立します。

主要成果

H.B. Fullerは、革新的な組織治癒技術を開発・製造する英国企業Advanced Medical Solutions Group plc (AMS) を、推奨される現金買収スキームで約6億6000万ポンド（約1280億円）で買収することを発表しました。この大型買収は、H.B. Fullerが医療接着剤および外科用製品市場におけるグローバルな地位を飛躍的に強化する戦略的な一歩です。

技術・事業詳細

- **AMSの主要製品:** AMSは、独自のLiquiBand®ブランドで知られる組織接着剤、手術用縫合糸、止血剤など、多岐にわたる高品質な外科用製品を提供しています。これらの製品は、手術時の出血コントロール、創傷閉鎖、瘢痕形成の軽減など、臨床現場で重要な役割を果たしています。
- **H.B. Fullerのポートフォリオ強化:** この買収により、H.B. Fullerは既存の医療用接着剤製品群にAMSの革新的な技術と製品を追加し、そのポートフォリオを大幅に強化します。特に、生体適合性接着剤や組織シーラントといった高付加価値分野での専門性が深まります。
- **グローバルプレゼンスの拡大:** AMSの確立された国際的な販売ネットワークとH.B. Fullerの既存のチャネルが統合されることで、両社の医療製品はより広い市場に到達できるようになります。これは、特に欧州やその他の成長市場におけるH.B. Fullerのプレゼンスを強化するものです。

背景・業界文脈

医療分野における接着剤およびシーラントの需要は、低侵襲手術の増加、感染症リスクの低減、患者の回復促進といったニーズに牽引され、着実に成長しています。従来の縫合やステープルに代わる組織接着剤は、手術時間を短縮し、合併症のリスクを低減する可能性を秘めているため、その採用が加速しています。H.B. Fullerは、この高成長市場におけるイノベーションと市場シェア獲得を重視しています。

今後の展望

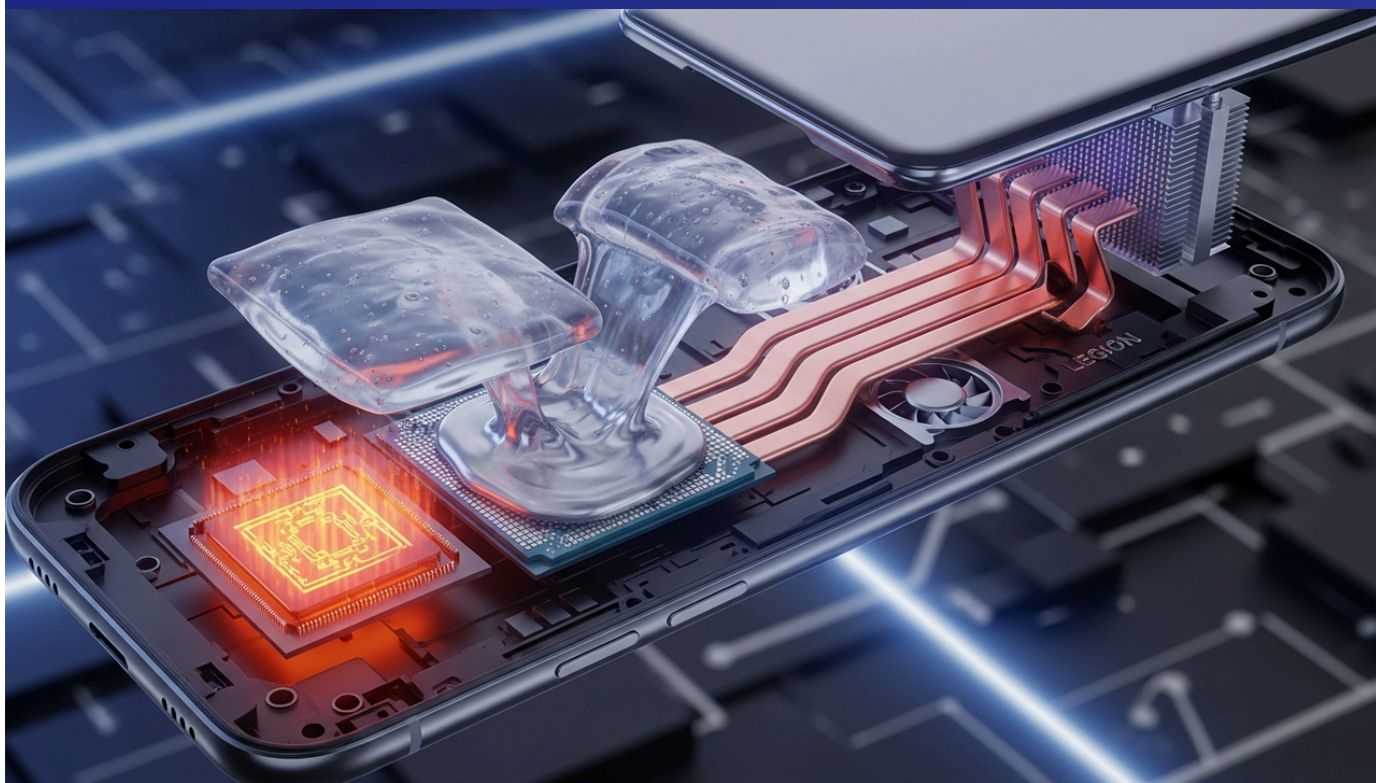
Advanced Medical Solutionsの買収は、H.B. Fullerが医療技術産業におけるリーダーとしての地位を確立する上で不可欠です。統合された事業は、研究開発への投資を拡大し、次世代の創傷治癒および外科用接着剤ソリューションの開発を加速させるでしょう。これにより、H.B. Fullerは、患者ケアの向上、医療従事者の手術効率化、そして医療コストの削減に貢献する革新的な製品を提供し続けることが期待されます。この動きは、医療接着剤市場の競争環境を再構築する可能性を秘めています。

元記事: <https://www.perivan.com/resources/news/scheme-document-published-for-the-660-million-recommended-cash-acquisition-by-h-b-fuller-for-advanced-medical-solutions/>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#14 Lenovo Legion Y70 2026ゲーミングフォン、 12W/mK液体金属と高熱伝導性ゲルで冷却性能を大幅強化

公開日 2026年07月20日 Cashkr 中国



概要

Lenovoの次世代ゲーミングフォン「Legion Y70 2026」は、その冷却システムを大幅に強化しました。5,500平方ミリメートルの大型ベイパーチャンバーに加え、12W/mKの液体金属熱伝導率と高熱伝導性ゲルを組み合わせることで、従来のサーマルペーストを上回る放熱性能を実現します。これにより、高負荷時のチップ温度を効率的に管理し、長時間の安定したゲームプレイや高いパフォーマンスを維持します。

主要成果

Lenovoの次世代ゲーミングフォン「Lenovo Legion Y70 2026」は、革新的な冷却システムを搭載し、高負荷時のパフォーマンス維持に大きく貢献します。このデバイスは、5,500平方ミリメートルの広大なベイパーチャンバーと、驚異的な熱伝導率12W/mKを誇る液体金属、さらに高熱伝導性ゲルを組み合わせた複合冷却ソリューションを採用しています。

技術・臨床詳細

- **液体金属の採用:** 従来の一般的なサーマルペーストと比較して、液体金属ははるかに高い熱伝導率（通常80W/mK以上だが、このシステムでは12W/mKと明記されており、何らかの複合評価値か最低保証値の可能性）を持ちます。これにより、チップ表面で発生した熱をベイパーチャンバーへと高速かつ効率的に伝達することが可能になります。
- **ベイパーチャンバーとの連携:** 5,500平方ミリメートルという大型のベイパーチャンバーは、液体金属によって迅速に伝達された熱を広範囲に拡散し、効率的な気化・凝縮サイクルを通じて放熱します。この組み合わせが、システム全体の冷却性能を最大化します。
- **高熱伝導性ゲルの補完:** 液体金属が適用できない部分や、隙間を埋めるために、高熱伝導性ゲルが補助的に使用されます。これにより、熱が逃げることなく効率的に冷却システム全体に伝達されるように、熱経路の完全性が保たれます。
- **高負荷環境への最適化:** ゲーミングフォンは、高いグラフィック性能を長時間維持する必要があるため、強力な冷却システムが不可欠です。この複合冷却システムは、CPUやGPUからの大量の発熱を効果的に管理し、サーマルスロットリング（熱による性能低下）を防ぎ、安定した高いフレームレートを提供します。

背景・業界文脈

スマートフォン市場、特にゲーミングフォン分野では、高性能プロセッサの搭載と薄型化が進む中で、熱管理が最大の課題の一つとなっています。効率的な冷却システムは、デバイスの性能だけでなく、バッテリー寿命やユーザー体験にも直接影響します。液体金属やベーパーチャンバーといった技術は、ハイエンドPCやサーバーで実績がありますが、それを小型のモバイルデバイスに最適化して搭載することが、各メーカーの差別化戦略となっています。

今後の展望

Lenovo Legion Y70 2026の冷却技術は、次世代ゲーミングフォンの性能基準を再定義する可能性を秘めています。この先進的な熱管理ソリューションは、将来のモバイルデバイスがより強力なチップセットを搭載し、さらに複雑なアプリケーションや高グラフィックゲームを安定して実行するための道を開くでしょう。液体金属や高度な熱伝導材料の採用は、ゲーミングフォンだけでなく、AI処理を多用するスマートフォンや高性能タブレットなど、幅広いモバイルデバイスに普及していくことが期待されます。

元記事: <https://www.cashkr.com/articles/lenovo-legion-y70-2026-geekbench>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#15 AtlasPCB、BGAアンダーフィル選定ガイドを公開、キャピラリーフローとリワーク可能処方を比較

公開日 2026年07月21日 AtlasPCB 不明



概要

AtlasPCBは、PCBエンジニアリングに関するブログ記事を通じて、BGA（Ball Grid Array）アンダーフィルの選定ガイドを公開しました。特にBGAアンダーフィルに関する記事では、キャピラリーフロー、モールドアンダーフィル、およびリワーク可能な処方を詳細に比較しています。自動車および航空宇宙アプリケーション向けに、プロセスパラメータ、CTE（熱膨張係数）マッチング、信頼性データを提供し、エンジニアが最適なアンダーフィル材料を選択できるよう支援します。

主要成果

AtlasPCBは、プリント回路基板（PCB）エンジニアリングに関する深い洞察を提供するブログシリーズの一環として、BGA（Ball Grid Array）アンダーフィル選定に関する包括的なガイドを公開しました。このガイドは、特にキャピラリーフロー、モールドアンダーフィル、リワーク可能な処方など、主要なアンダーフィル技術を詳細に比較分析しており、エンジニアが特定のアプリケーション要件に最適な材料を選択する上で貴重な情報を提供します。

技術・事業詳細

- **BGAアンダーフィルの重要性:** BGAパッケージは、高密度集積回路において優れた電気的性能を発揮しますが、熱的・機械的ストレスに対して脆弱です。アンダーフィル材料は、はんだ接合部に充填され、熱膨張係数（CTE）のミスマッチによるストレスを緩和し、はんだ疲労を抑制することで、パッケージの信頼性と寿命を大幅に向上させます。
- **主要なアンダーフィル技術の比較:**
 - **キャピラリーフローアンダーフィル (CUF):** BGAパッケージの周囲に材料を塗布し、毛細管現象によってはんだボールの下に流れ込ませる伝統的な手法です。高い信頼性を提供しますが、フロー時間が長く、ボイド発生リスクがあります。
 - **モールドアンダーフィル (MUF):** パッケージ全体をモールド樹脂で封止する際に、はんだボールの下にも材料を充填する手法です。プロセスステップを削減できますが、リワークが困難です。
 - **リワーク可能処方:** 特定の温度や化学処理によって取り外しが可能なアンダーフィル材料です。これにより、欠陥のあるパッケージを修理し、コストを削減する柔軟性を提供します。しかし、初期の接着強度や信頼性において、非リワーク可能材料に劣る場合があります。
- **自動車・航空宇宙分野への適用:** これらの産業では、極端な温度変化、振動、衝撃に対する高い信頼性が求められます。ガイドでは、これらの過酷な環境下での性能を保証するためのプロセスパラメータ、最適なCTEマッチング、および長期信頼性に関する詳細なデータが提供されています。

背景・業界文脈

半導体パッケージングは、小型化、高性能化、低コスト化が絶えず求められる中で進化を続けています。BGAパッケージはその要求に応える主要なソリューションの一つですが、高信頼性を実現するためには、アンダーフィル材料の選択と適用技術が極めて重要です。特に、自動運転システムを搭載する自動車や、ミッションクリティカルな航空宇宙機器では、故障が許されないため、アンダーフィル材料の品質と信頼性への要求は非常に高いです。

今後の展望

AtlasPCBのこのようなガイドは、PCB設計および製造エンジニアが、複雑なBGAアンダーフィルの課題を克服し、次世代の高性能で高信頼性な電子製品を開発する上で不可欠なリソースとなるでしょう。今後、アンダーフィル材料は、より短い硬化時間、さらなる低CTE、優れたリワーク性、および環境適合性を備えるよう進化し続けると予想されます。これらの技術革新は、エレクトロニクス産業全体の発展を支え、新たなアプリケーション分野を開拓する鍵となります。

元記事: <https://www.atlaspcb.com/blog/>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#16 CPWポンプ市場、半導体・エレクトロニクス製造の成長で2035年までに高みへ到達予測

公開日 2026年07月20日 IndexBox 不明



CPW Pump Market

Semiconductor manufacturing reach by 2035

July 20, 2026

概要

本記事は、CPWポンプ市場に関する市場調査レポートの概要紹介です。CPWポンプ市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測されており、半導体およびエレクトロニクス製造の成長に牽引されます。3Dスタッキングやヘテロジニアス統合を含む先進パッケージング技術の台頭により、アンダーフィル材料や熱界面コンパウンドの精密なディスペンスの需要が高まっています。これらのポンプは、高精度な材料供給と効率的な製造プロセスに不可欠です。

詳細

本記事は、IndexBoxが発行した市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

- **調査対象市場:** CPWポンプ市場（CPW Pump Market）
- **対象地域:** グローバル
- **調査期間:** 2026年～2035年（予測）
- **発行会社:** IndexBox

主要な調査結果

CPWポンプ市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%で成長すると予測されており、半導体およびエレクトロニクス製造業界の力強い成長によって大きく牽引されています。CPWポンプは、高精度な液体の送液・ディスペンスを可能にする重要な装置であり、特に先進パッケージング技術においてその需要が高まっています。

- **半導体・エレクトロニクス製造の成長:** データセンター、AI、IoT、5G通信といった分野における需要増加が、半導体チップの生産量を押し上げています。これに伴い、チップ製造プロセスにおける高精度な材料供給システムの必要性が高まっています。
- **先進パッケージング技術の台頭:** 3Dスタッキングやヘテロジニアス統合などの先進パッケージング技術は、チップの小型化、高性能化、高密度化を実現するために不可欠です。これらの技術では、アンダーフィル材料、熱界面コンパウンド、接着剤、シーリング材などの液状材料を極めて正確に塗布する必要があります。CPWポンプは、これらの精密ディスペンス要件を満たす上で重要な役割を果たします。
- **精密ディスペンスの需要:** 先進パッケージングにおいて、材料の塗布精度は最終製品の信頼性、熱管理性能、電気的性能に直接影響します。CPWポンプは、微量の液体を高い再現性と精度で供給できるため、品質向上と歩留まり改善に貢献します。

発行会社について

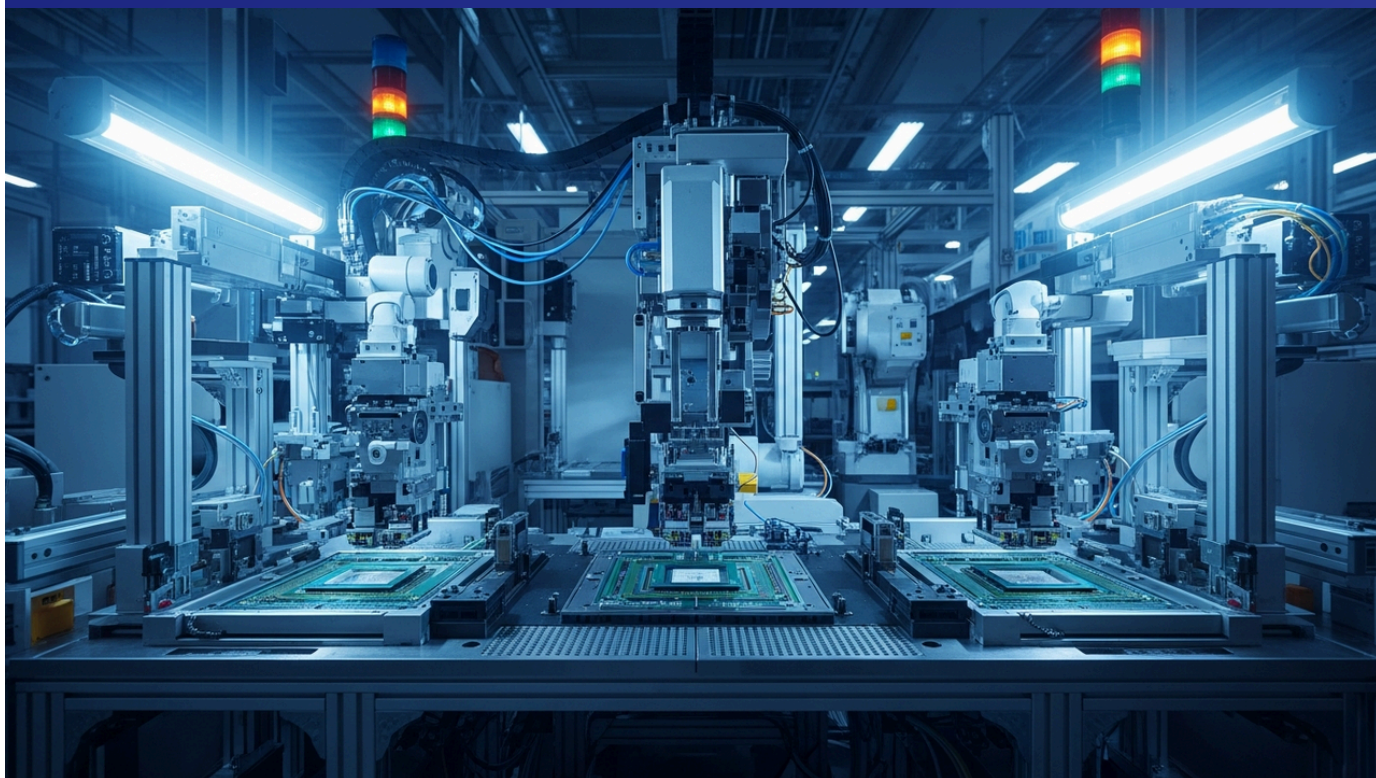
IndexBoxは、グローバルな市場データ、分析、予測を提供するAI駆動型の市場調査プラットフォームです。同社は、様々な業界にわたる包括的な市場レポートを提供し、企業が戦略的な意思決定を行うための詳細な洞察とトレンド分析を提供しています。

元記事: <https://www.indexbox.io/blog/cpw-pump-market-forecast-points-higher-toward-2035-on-semiconductor-expansion-and-precision-automation-demand/>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#17 Intel、マレーシア・クリムで先進パッケージングテスト工程エンジニアを募集、CUFモジュール改良と新材料適用を推進

公開日 2026年07月20日 Jooble アメリカ



概要

Intelは、マレーシアのクリム拠点で、先進製造テストプロセスの設計・開発をリードするシニアモジュールテストエンジニアを募集しています。この職務は、ポストパッケージングのバーンイン、最終テスト、システムテストモジュールをサポートし、キャピラリーアンダーフィル（CUF）モジュールの改良と新型材料の適用を通じて、パッケージ製造の効率を向上させることが含まれます。この動きは、半導体先進パッケージング技術の進化を加速させるIntelの戦略を示しています。

主要成果

Intelは、マレーシアのクリムにある最先端製造拠点において、先進製造テストプロセスの設計と開発を主導するシニアモジュールテストエンジニアの採用を開始しました。この重要な役割は、ポストパッケージングのバーンイン、最終テスト、およびシステムテストモジュールのサポートを通じて、半導体パッケージ製造の効率と信頼性を向上させることを目的としています。

技術・事業詳細

- **職務内容の重点:** 募集されるエンジニアは、キャピラリーアンダーフィル（CUF）モジュールの改良と新型材料の適用に深く関与します。CUFは、BGA（Ball Grid Array）などのフリップチップパッケージにおいて、はんだバンプ間の隙間を充填する材料であり、熱膨張係数（CTE）のミスマッチによるストレスを軽減し、はんだ接合の信頼性を高める上で不可欠です。
- **製造効率の向上:** CUFプロセスと新材料の最適化は、パッケージングの歩留まり向上、不良率の削減、製造サイクルタイムの短縮に直結します。これにより、Intelは増大する高性能半導体製品の需要に対応し、競争力を維持することができます。
- **先進パッケージングへのコミットメント:** この採用は、Intelが3Dスタッキングやヘテロジニアス統合といった先進パッケージング技術に積極的に投資していることを示しています。これらの技術は、チップレットベースの設計において複数の異なるダイを統合し、性能と効率を最大化する上で中心的な役割を果たします。
- **テストプロセスの最適化:** ポストパッケージングテストは、製品の品質保証と信頼性確保の最終段階であり、テストカバレッジの向上、テスト時間の短縮、診断能力の強化が求められます。採用されるエンジニアは、これらの最適化を通じて、製品の市場投入を加速させるでしょう。

背景・業界文脈

半導体業界は、ムーアの法則の物理的限界に直面し、従来の微細化以外の方法で性能向上を図る必要に迫られています。その主要な解決策の一つが、先進パッケージング技術です。特に、チップレットアーキテクチャは、異なる機能を持つチップレットを効率的に統合することで、性能と製造歩留まりの両方を最適化する有望なアプローチとされています。CUFなどの材料技術とテスト技術の進化は、このトレンドを支える基盤となります。

今後の展望

マレーシア・クリムでのシニアモジュールテストエンジニアの採用は、Intelが世界的な先進パッケージングエコシステムの構築と強化を進めていることの証です。CUFモジュールの改良と新材料の適用は、高性能CPU、GPU、AIアクセラレータなどの次世代製品の安定供給と品質確保に直接貢献します。この取り組みは、Intelが半導体技術のフロンティアを拡大し、未来のコンピューティング需要に応えるための重要な投資であり、業界全体に大きな影響を与えるでしょう。

元記事: <https://my.jooble.org/jdp/8299875123171152330>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#18 リチウム電池パック用シリコンフォーム市場、熱暴走規制により2035年まで成長予測：EVバッテリーが最大最終用途

公開日 2026年07月22日 IndexBox 不明



概要

本記事は、リチウム電池パックアセンブリ用シリコンフォーム市場に関する市場調査レポートの概要紹介です。この市場は、熱暴走規制の強化により2035年まで成長が見込まれており、電気自動車（EV）バッテリーパックが最大の最終用途セグメントです。シリコンフォームは、EVバッテリーパック内でセル間の圧縮パッド、熱界面材料、および熱暴走防止のための防火バリアとして広く使用され、安全性と性能向上に貢献しています。

詳細

本記事は、IndexBoxが発行した市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

- **調査対象市場:** リチウム電池パックアセンブリ用シリコーンフォーム市場 (Silicone Foam for Lithium Battery Pack Assemblies Market)
- **対象地域:** グローバル
- **調査期間:** 2035年まで (予測)
- **発行会社:** IndexBox

主要な調査結果

リチウム電池パックアセンブリ用シリコーンフォーム市場は、熱暴走規制の厳格化を背景に、2035年まで継続的な成長が予測されています。この成長の主要な牽引役は電気自動車 (EV) 産業であり、EVバッテリーパックがシリコーンフォームの最大の最終用途セグメントを占めています。

- **熱暴走規制の強化:** 世界各国でEVの安全性に関する規制が強化されており、バッテリーの熱暴走を防ぐための設計が義務付けられています。シリコーンフォームは、その優れた耐熱性、難燃性、および電気絶縁性から、熱暴走イベントの伝播を遅らせ、安全性を向上させるための重要な材料として注目されています。
- **EVバッテリーパックでの広範な採用:** シリコーンフォームはEVバッテリーパック内で多岐にわたる用途で採用されています。具体的には、以下の役割を果たします。
 - **セル間の圧縮パッド:** バッテリーセル間の隙間を埋め、振動や衝撃からセルを保護し、圧縮応力を均等に分散します。
 - **熱界面材料 (TIM) :** セルから冷却システムへの熱伝達を効率化し、バッテリーパック全体の温度管理を最適化します。
 - **防火バリア:** 万が一、熱暴走が発生した場合に、その影響を隣接するセルや車両全体に広がるのを防ぐための防火バリアとして機能します。
- **成長要因:** EVの生産台数増加、バッテリー容量の拡大、および消費者の安全性への意識向上は、この市場の成長をさらに加速させるでしょう。

発行会社について

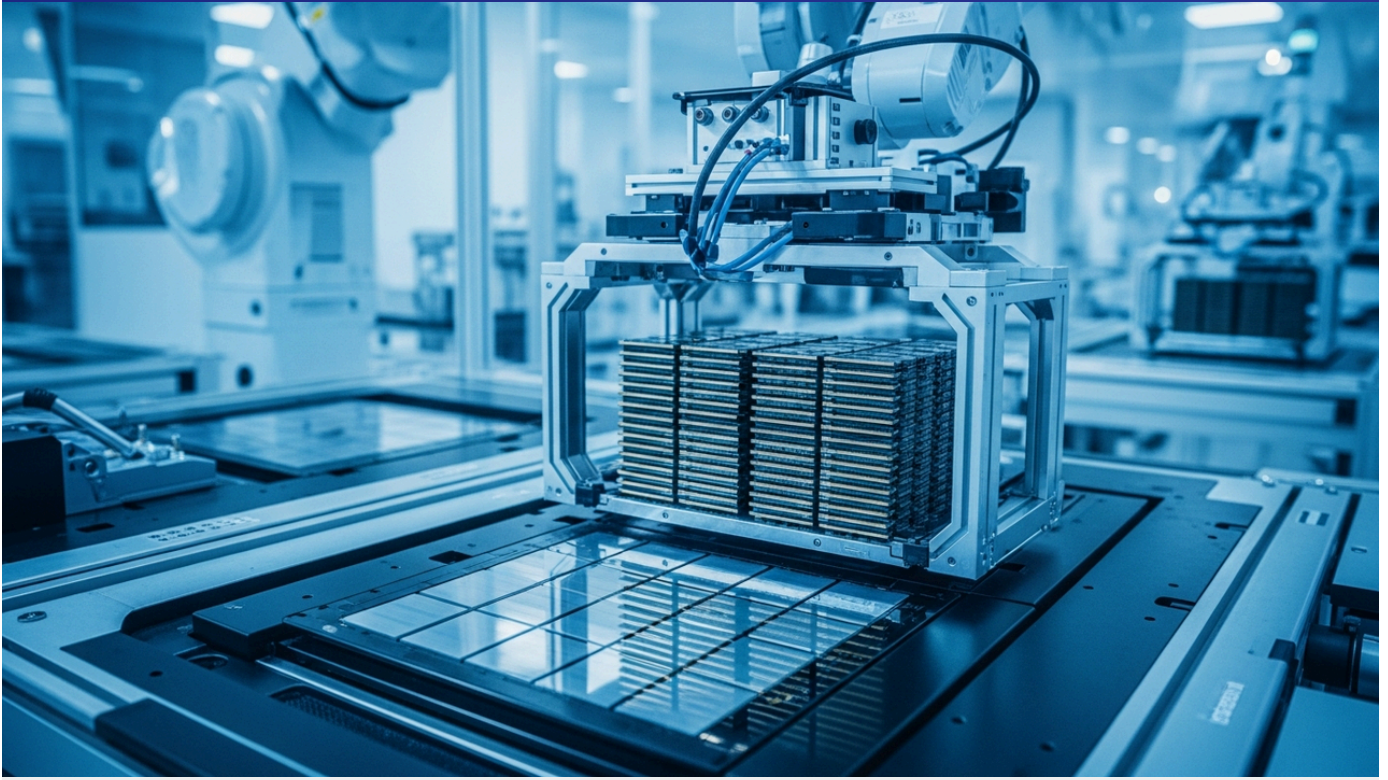
IndexBoxは、AI駆動型テクノロジーを活用して、様々な産業分野の市場に関する詳細なデータ、分析、予測を提供するグローバルな市場調査会社です。同社のレポートは、企業が情報に基づいた戦略的決定を下すための包括的な洞察を提供します。

元記事: <https://www.indexbox.io/blog/silicone-foam-for-lithium-battery-pack-assemblies-market-demand-to-accelerate-by-2035-on-ev-safety-mandates/>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#19 SK hynix、米国インディアナ州に先進パッケージングプラントを建設、HBM3需要急増に対応

公開日 2026年07月22日 BigGo Finance 韓国



概要

SK hynixは、HBM3（High Bandwidth Memory 3）需要の急増に対応するため、積極的な能力拡大計画を推進しています。同社は2028年後半に米国インディアナ州で先進パッケージングプラントの操業を開始する予定であり、さらに2026年後半には韓国清州のM15X工場、2027年末までにはP&T7先進パッケージング工場を完成させる計画です。これらの投資は、AI半導体市場におけるHBMの重要性の高まりを反映しています。

主要成果

SK hynixは、高性能メモリであるHBM3（High Bandwidth Memory 3）の市場需要が急増している状況に対応するため、世界各地で積極的な生産能力拡大戦略を展開しています。同社は、2028年後半に米国インディアナ州で新たな先進パッケージングプラントを稼働させる計画を立てており、これによりHBMの供給体制を大幅に強化します。

技術・事業詳細

- **HBM3需要の背景:** HBM3は、AI半導体、高性能コンピューティング（HPC）、データセンターなど、膨大なデータを高速で処理する能力が求められるアプリケーションで不可欠なメモリです。AI技術の進化に伴い、HBM3の需要は前例のないペースで増加しています。
- **米国インディアナ州プラント:** 2028年後半に操業開始予定の米国インディアナ州の先進パッケージングプラントは、SK hynixのグローバルサプライチェーンにおいて重要な位置を占めることになります。この施設では、HBMの3DスタッキングやTSV（Through Silicon Via）技術を用いた高度なパッケージング工程が行われると見られます。
- **韓国国内の拡張計画:** 米国での投資に加え、SK hynixは韓国国内でも生産能力の増強を進めています。2026年後半には清州のM15X工場を、そして2027年末までにはP&T7先進パッケージング工場を完成させる予定です。これらの国内投資は、HBM生産の核となる部分を強化し、全体的な生産量を増加させるものです。
- **先進パッケージング技術の重要性:** HBMは、複数のDRAMチップを垂直に積み重ね、微細なTSVで接続する先進パッケージング技術の結晶です。この技術は、高帯域幅と低消費電力を同時に実現し、AIチップの性能を最大限に引き出す上で不可欠です。

背景・業界文脈

近年、生成AIの急速な発展により、AIチップ市場は爆発的に成長しています。NVIDIAなどのAIチップメーカーは、高性能AIアクセラレータにHBMを不可欠なコンポーネントとして採用しており、HBMの安定供給がAI産業全体の成長を左右する要因となっています。SK hynixは、HBM市場における主要なプレイヤーとして、この機会を捉え、戦略的な投資を進めています。

今後の展望

SK hynixのこれらの積極的な投資は、HBM3および将来のHBM技術におけるリーダーシップを確固たるものにし、AIエコシステムの発展に大きく貢献するでしょう。グローバルな生産体制の強化は、サプライチェーンのリスクを分散し、顧客への安定供給を保証する上でも重要です。今後、HBMの技術はさらに進化し、より高い帯域幅と集積度を持つ次世代製品が登場することが期待されており、SK hynixはその最前線でイノベーションを推進していく方針です。

元記事: <https://finance.biggo.com/quote/005930.KS>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#20 Corvette C8のリアインパクトバー交換でGMが「特定の接着剤」の使用を厳格指示、安全な修理を保証

公開日 2026年07月22日 (自動車修理ニュース) アメリカ



概要

Corvette C8のリアインパクトバー交換において、GMはアルミニウムパネル接合用構造接着剤、シート成形コンパウンド（SMC）接着剤、構造用炭素繊維接着剤キットなど、特定の接着剤の使用を厳格に指示しています。これは安全で適切な修理を保証するためのもので、代替品の使用は固く禁じられています。この指示は、高性能車両の修理における接着技術の重要性を浮き彫りにしています。

主要成果

ゼネラルモーターズ（GM）は、高性能スポーツカーCorvette C8のリアインパクトバー交換作業において、修理マニュアルで指定された特定の接着剤を正確に使用することを強く指示しました。この指示は、車両の安全性と構造的完全性を保証するために極めて重要であり、いかなる代替接着剤の使用も厳しく禁じられています。

技術・事業詳細

- **特定接着剤の使用義務:** GMは、Corvette C8のリアインパクトバー交換プロセスにおいて、以下の種類の接着剤の使用を明示しています。
 - **アルミニウムパネル接合用構造接着剤:** 車体のアルミニウム構造部品を接合するために特別に配合された接着剤です。高い強度と耐久性を持ち、衝突安全性に貢献します。
 - **シート成形コンパウンド（SMC）接着剤:** SMCは軽量で高剛性の複合材料であり、Corvette C8の車体にも使用されています。この接着剤は、SMC部品を効果的に接合するために設計されています。
 - **構造用炭素繊維接着剤キット:** Corvette C8には炭素繊維複合材料が戦略的に使用されており、これらの部品の構造的完全性を維持するために、専用の接着剤キットが求められます。
- **厳格な品質管理:** GMが代替品の不使用を強調しているのは、指定された接着剤がCorvette C8の材料特性、設計荷重、および衝突安全性基準に適合するように厳密にテスト・検証されているためです。異なる接着剤を使用すると、修理箇所の強度が不足したり、経年劣化により問題が生じる可能性があります。
- **修理技術者への影響:** この指示は、修理工場や技術者に対し、GMの公式修理手順に厳格に従い、推奨される材料を使用することの重要性を再認識させるものです。高性能車両の修理には、高度な知識と正確な実行が不可欠となります。

背景・業界文脈

現代の自動車製造では、燃費効率の向上と安全性向上のため、アルミニウム、炭素繊維複合材料、高張力鋼板など、多様な軽量素材が組み合わされています。これらの異種材料を効果的に接合するために、構造用接着剤が溶接や機械的ファスナーに代わって広く採用されています。接着剤は、応力集中を緩和し、振動減衰特性を向上させるという利点がある一方で、その選択と適用は車両の設計と密接に結びついており、安全性に直結します。

今後の展望

Corvette C8のような高性能車両における接着剤使用の厳格な指示は、自動車修理業界全体に対する傾向を示すものです。今後、より多くの車両で先進的な材料と接着技術が採用されるにつれて、メーカーからの具体的な接着剤の推奨と、修理技術者によるその厳守が不可欠となるでしょう。これは、接着剤メーカーにとって、特定の自動車メーカーの要求を満たす高性能接着剤を開発・供給するための新たなビジネス機会を創出するとともに、修理業界には適切なトレーニングと認証プログラムの必要性を高めることとなります。

元記事: <https://rts.i-car.com/crn-2443.html>

#21 チップレットアンダーフィルディスペンシング市場、HBM・C2Wハイブリッドボンディングのボイド低減ニーズで2036年まで成長

公開日 2026年07月22日 Fact.MR アメリカ

Chiplet Underfill Dispensing Market

Void Reduction needs in HBM
HBM and C2rid bonding until 2036

概要

本記事はFact.MRが発行した市場調査レポートの概要紹介です。チップレットアンダーフィルディスペンシング市場は、HBM製造におけるウェハーレベルアンダーフィルの需要と、チップ・ツー・ウェハー（C2W）ハイブリッドボンディングでのボイド低減のため、調整された粘度・硬化プロファイルを持つ接着剤の必要性により成長しています。OSATプロバイダーは多様なダイサイズや基板仕上げに対応する材料とレシピを認証しており、40 μm以下のバンプピッチではウェハーレベルアンダーフィルラミネーションや非導電性フィルムが技術的課題を解決しています。

詳細

本記事はFact.MRが発行した市場調査レポートの概要紹介です。チップレットアンダーフィルディスペンシング市場は、高性能半導体パッケージング、特に高帯域幅メモリ（HBM）やチップ・ツー・ウェハー（C2W）ハイブリッドボンディングの進化に伴い、2036年まで継続的な成長が予測されています。

レポート概要

レポートは、チップレット技術の進展がアンダーフィルディスペンシング市場に与える影響に焦点を当てています。HBM製造におけるウェハーレベルアンダーフィルの重要性や、C2Wハイブリッドボンディングにおけるボイド（空隙）発生低減が主要な課題として挙げられています。これに対応するため、市場では粘度や硬化プロファイルが精密に調整された接着剤への需要が高まっています。また、OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）プロバイダーが、さまざまなダイサイズ、基板仕上げ、そして顧客の厳しい信頼性要件を満たすアンダーフィル材料とディスペンシングレシピの認証に積極的に取り組んでいる状況が報告されています。

主要な調査結果

- HBM製造におけるウェハーレベルアンダーフィルおよびC2Wハイブリッドボンディングのボイド低減ニーズが市場成長を牽引しています。
- 精密に調整された粘度と硬化プロファイルを持つアンダーフィル接着剤が、高性能パッケージングの信頼性向上に不可欠です。
- OSATプロバイダーは、多様な半導体デバイスとプロセス要件に対応するため、アンダーフィル材料とディスペンシングレシピの認証を積極的に進めています。
- キャピラリーアンダーフィルは、熱機械的応力からの保護において依然として基準となるプロセスですが、40 μm 以下の微細なバンプピッチではウェハーレベルアンダーフィルラミネーションや非導電性フィルム（NCF）がボトルネックを解消する重要な技術として浮上しています。

発行会社について

Fact.MRは、幅広い産業分野における深い市場洞察と詳細な分析を提供するグローバルな市場調査会社です。同社のレポートは、市場規模、トレンド、競合分析、成長機会に関する実用的な情報を提供し、企業が戦略的な意思決定を行う上で役立つことを目指しています。

元記事: <https://www.factmr.com/report/chiplet-underfill-dispensing-market>

収集日: 2026年07月24日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)